



通富微电子股份有限公司

与

海通证券股份有限公司

关于通富微电子股份有限公司

非公开发行股票

发审委会议准备工作告知函的回复

保荐机构（主承销商）



（上海市广东路 689 号）

二〇二二年一月

中国证券监督管理委员会：

根据贵会 2021 年 12 月 22 日出具的《关于请做好通富微电非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的要求，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”、“申请人”、“通富微电”）会同海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“海通证券”）及致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”、“致同会计师”）、北京大成律师事务所（以下简称“律师”、“大成律师”）等中介机构按照贵会的要求对反馈意见中提出的问题进行了认真研究，现逐条进行说明，具体回复如下。

除非本回复中另有说明，《海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票之尽职调查报告》中使用的释义和简称适用于本回复。

本回复中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

目录

问题 1、关于业绩波动	4
问题 2、关于厦门通富	37
问题 3、关于“存贷双高”	43
问题 4、关于商誉	60

问题 1、关于业绩波动

报告期各期，申请人的净利润分别为 15,303.14 万元、3,744.25 万元、38,851.05 万元和 41,195.45 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 4,251.31 万元、-13,040.45 万元、20,715.65 万元和 36,262.06 万元，主营业务毛利率分别为 15.56%、12.70%、15.01%和 17.74%。

请申请人：（1）说明 2019 年扣非后净利润大幅亏损及非经常性损益金额较大的原因及合理性，报告期各项政府补助的内容、金额、取得依据和到账时间，政府补助计入当期损益或递延收益、计入经常性损益和非经常性损益的划分标准、依据和金额；（2）按业务类别说明公司所处行业全产业链（包括上下游各个环节）的简要情况，包括但不限于业务流程、市场容量、市场竞争等，并结合前述情况说明报告期内业绩波动的合理性，收入变动和净利润变动的匹配性，是否与同行业公司变动趋势一致；（3）结合同行业可比上市公司对比情况分析报告期内主营业务毛利率波动的原因及合理性，并说明毛利率波动对持续盈利能力的影响，相关风险是否充分披露。请保荐机构、申报会计师说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。

回复：

【发行人说明】

一、说明 2019 年扣非后净利润大幅亏损及非经常性损益金额较大的原因及合理性，报告期各项政府补助的内容、金额、取得依据和到账时间，政府补助计入当期损益或递延收益、计入经常性损益和非经常性损益的划分标准、依据和金额；

（一）2019 年扣非后净利润大幅亏损及非经常性损益金额较大的原因及合理性

报告期内，公司经营情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年
营业收入	1,120,360.64	1,076,870.00	826,657.46	722,286.30
净利润	71,649.08	38,851.05	3,744.25	15,303.14

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年
归母净利润	70,310.77	33,842.79	1,914.14	12,693.96
归属于公司普通股股东的非经常性损益	7,070.27	13,127.14	14,954.60	8,442.64
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	63,240.50	20,715.65	-13,040.45	4,251.31
综合毛利率	18.78%	15.47%	13.67%	15.90%
期间费用率	12.32%	12.98%	15.58%	14.38%

2019年扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润大幅下滑，主要由于发行人2019年净利润同比下滑较多以及非经常性损益有所上升。

1、2019年净利润同比下滑原因

公司2019年净利润下滑主要系综合毛利率下滑和期间费用率上升所致。

(1) 主营业务毛利率下降

发行人2019年度综合毛利率较2018年度下降2.23%，主要由于发行人主营业务毛利率下降2.86%所致。主营业务毛利率的下降，主要原因包括折旧大幅增加、行业景气度下行、产品及客户结构调整导致低毛利率产品占比上升以及原材料价格上升。具体原因及合理性分析如下：

① 固定资产增加导致折旧大幅增加

为保持竞争优势，根据行业发展趋势完善产品布局，增加未来的营收规模，增强未来的可持续盈利能力，发行人2018年及2019年持续进行扩产，导致2019年度达到可使用状态的固定资产规模增加较多，相应的折旧金额上升较快。2019年，公司固定资产原值较2018年增加205,375.76万元，折旧与摊销增加20,225.48万元。

公司2018年、2019年固定资产投入的增加，虽然短期降低了公司主营业务毛利率，但为公司后续产能扩大、销售增长奠定了良好基础。

② 市场景气度下行拉低公司毛利率

由于半导体行业为周期性行业，自2018年下半年开始，半导体行业增速出现下滑，同时叠加中美贸易摩擦影响，在2018年末及2019年初行业景气度极速

下滑，2019 年上半年销售额持续位于低谷，受此影响，半导体行业及封测行业毛利率均呈现下滑趋势。

在行业整体趋势下行的大背景下，公司下游客户备货谨慎，为了保证开工率，公司积极通过调整产品结构、客户结构等方式抢抓订单、开拓市场，导致毛利率较低的产品比例有所增加，对综合毛利率造成了一定不利影响。

2020 年以来，由于市场需求的增加，封测行业景气度提升，毛利率呈上升趋势。

③在国产替代趋势带动下，客户结构调整对公司毛利率的影响

自 2018 年 6 月中美贸易摩擦发生以来，集成电路产业链国产替代的进程不断推进。发行人作为国内半导体封测行业的领先企业，积极参与到国产替代的进程中，与多家国内客户开展合作，2019 年境内收入同比增长 53.61%。

发行人境外客户主要为全球领先的半导体厂商，与其相比，国内厂商在产品需求、先进程度及价格敏感度方面有不同要求，国内客户 2019 年综合毛利率略低；发行人在国产化趋势愈发明显的大背景下积极调整销售策略，增加国内客户的开拓力度，提升境内收入占比，一定程度上拉低了公司整体毛利率。

2020 年以来，随着行业景气度的提升，公司境内业务收入快速增长的同时，毛利率也持续提升，成为公司业绩增长的重要动力。

④部分原材料价格上升进一步影响公司毛利率

公司生产经营所需的主要材料有基板、引线框架等。公司子公司通富超威苏州和通富超威槟城于 2019 年启动 7 纳米芯片量产，7 纳米产品为高端先进封装产品，由于当期该类产品耗用的主要材料基板的单价提升，导致毛利率水平随直接材料成本上升略有下降。

综上所述，发行人 2019 年综合毛利率下降 2.23%，主要由于折旧规模上升、市场景气度下行、客户结构和产品结构调整以及部分原材料价格上升等因素影响，毛利率变动趋势与发行人经营情况及行业趋势相符，具有合理性。

(2) 期间费用率上升

2018 年度及 2019 年度，发行人期间费用情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年度		2018 年度		增加额
	金额	占营收比例	金额	占营收比例	
销售费用	5,709.44	0.69%	5,346.72	0.74%	362.72
管理费用	31,752.49	3.84%	30,866.83	4.27%	885.66
研发费用	68,829.34	8.33%	56,224.63	7.78%	12,604.71
财务费用	22,506.44	2.72%	11,440.16	1.58%	11,066.28
期间费用合计	128,797.71	15.58%	103,878.34	14.38%	24,919.37

2019 年发行人期间费用较 2018 年上升 24,919.37 万元，主要由于研发费用及财务费用增加所致。

（1）财务费用增长

2019 年度，发行人母公司、南通通富及合肥通富持续投产，此外通富超威苏州及通富超威槟城为应对 AMD 7 纳米芯片封装需求，设备投资加大，营运资金需求增加，发行人 2019 年末银行借款余额增加 203,039.30 万元，2019 年度利息支出增加 5,022.79 万元。此外，受外币汇率变动影响，发行人 2019 年度汇兑收益较 2018 年度减少 4,769.27 万元。受前述主要因素影响，发行人 2019 年度财务费用较 2018 年度增长 11,066.28 万元。

（2）研发费用增长

2019 年度发行人研发费用较 2018 年度增长 12,604.71 万元，主要原因系：受行业特性影响，在行业技术日新月异发展的大背景下，为了提升我国半导体封测技术水平，同时维持技术优势为后续发展打好基础，发行人持续增加研发投入。2019 年与 2018 年相比，研发项目以及处于开发阶段的研发项目数量均有所增长，同时随着研发技术先进性的提升，单个项目的研发费用投入要求更高。

基于对市场发展方向的前瞻性判断，2017 年开始，发行人围绕中央处理器、汽车电子、消费电子等行业内先进封装技术发展的方向，在 7 纳米封测、新型传感器等方面持续加大研发投入。2019 年，发行人在上述领域研发项目投资 57,846.89 万元，其中 2019 年投入金额前五大研发项目情况如下：

单位：万元

项目	启动时间	主要应用	投入金额	研发时长
7 纳米封装测试技术相关项目	2017 年	CPU、GPU	10,013.25	持续研发
智能功率模块（IPM）封装技术研发	2017 年	汽车电子	7,408.82	三年
新型智能传感器封装技术开发及产业化	2017 年	消费电子	7,398.41	三年
新型三维传感器产品设计与封装技术开发	2017 年	消费电子	7,349.41	三年
电源管理用第三代半导体圆片的集成封装工艺研发	2017 年	电源管理	6,422.46	三年
合计			38,592.35	-

上述项目均为 2017 年立项并启动研发的项目，在 2019 年处于开发的关键阶段，产生了较多的研发支出。其中通富超威苏州和通富超威槟城在 CPU、GPU、服务器领域成功研发出具有竞争力的 7 纳米封测产品，成为国内首个大规模封测 7 纳米及 9 芯片服务器产品的工厂。此外，通富微电本部作为发行人主要技术研发基地，根据市场需求投入研发功率模块、传感器及电源管理产品，相关技术均为行业先进水平并最终应用于发行人核心产品当中。

正因为有了领先的技术储备，公司得到了行业龙头企业的认可，获得了更多的发展机遇，因为具备了领先的 7 纳米封测、功率模块、新型传感器及电源管理等技术的支撑，公司紧抓行业发展机遇，2020 年、2021 年业绩快速增长。

2、2019 年非经常性损益上升原因

报告期内，发行人非经常性损益情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年	2019 年	2018 年
非流动资产处置损益	20.54	633.55	142.42	-85.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,610.43	13,924.96	16,081.44	8,804.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42.64	-26.28	36.77	-165.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,956.84	1,302.98	1,229.41	1,562.96

非经常性损益总额	8,630.44	15,835.21	17,490.04	10,116.50
减：非经常性损益的所得税影响数	1,293.92	2,212.72	2,209.08	1,422.55
非经常性损益净额	7,336.53	13,622.49	15,280.96	8,693.95
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	266.26	495.34	326.36	251.31
归属于母公司所有者的非经常性损益	7,070.27	13,127.15	14,954.60	8,442.64
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	63,240.50	20,715.65	-13,040.45	4,251.31

公司非经常性损益主要为收到的政府补助，主要为积极开展封装测试领域的技术研发并承接多种国家或省、市科研项目所致，尤其是承担了国家部分 02 专项的研发任务，相应取得了金额较大的国家和地方政府补助拨款。

综上所述，公司 2019 年扣非后净利润亏损、非经常性损益金额较大主要系主营业务毛利率下降、期间费用率上升以及政府补助增加所致，具有合理性。

（二）报告期各项政府补助的内容、金额、取得依据和到账时间，政府补助计入当期损益或递延收益的金额

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定：

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。

报告期内，公司累计取得政府补助 300 万元以上的项目情况如下：

项目名称	到账时间、金额（万元）					取得依据
	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-9 月	合计	
02 专项补助	11,704.28	1,903.85	2,904.55	--	16,512.68	<p>根据财政部《财政部关于核定科技重大专项 2009 年立项项目（课题）中央财政资金预算并下达 2009 年年度预算的通知》（财教〔2009〕479 号）、江苏省科学技术厅苏科计【2011】294 号文，江苏省科学技术厅《关于拨付国家“集成电路”科技重大专项立项项目 2014 年国拨经费的通知》（苏科技发【2014】192 号）文，根据极大规模集成电路制造装备及成套工艺重大专项实施管理办公室发布《关于 02 专项 2017 年度项目立项批复的通知》（ZX02(2017)010 号），根据上海市科学技术委员会《关于拨付极大规模集成电路制造装备及成套工艺科技重大专项 2017 年中央财政预算经费的函》（沪科【2017】394 号），根据上海市科学技术委员会《关于拨付极大规模集成电路制造装备及成套工艺国家科技重大专项 2020 年中央财政预算经费的函》（沪科 2020【325】号），根据“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室《关于同意“3D NAND 闪存超薄芯片多叠层产品封装技术开发及产业化”任务增加联合承担单位的通知》、《极大规模集成电路制造装备及成套工艺科技重大专项预算拆分报告》及南通市科学技术局和财政局 2018 年 12 月 29 日发布的《关于下达 2018 年度第一批世级科技计划项目和财政资助科技经费（含分年度与省以上匹配）的通知》通科计【2018】152 号，公司承担了相关项目并取得</p>

项目名称	到账时间、金额（万元）					取得依据
	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-9 月	合计	
						相应补助。
园区拨付财政奖励	--	--	3,436.12	--	3,436.12	根据苏锡通科技产业园区党政办公室办文单《关于南通通富微电子有限公司高管人才奖励、贷款贴息、研发费用奖励的申请》【2020】230 号】文件，公司收到江苏南通苏通科技产业园区财政局拨付的补助款。
国产集成电路封测关键设备与材料量产应用工程	--	--	2,706.48	--	2,706.48	根据上海市科学技术委员会《关于拨付极大规模集成电路制造装备及成套工艺国家科技重大专项 2020 年中央财政预算经费的函》（沪科 2020【325】号），公司收到江苏长电科技股份有限公司转拨的补助款。
集成电路封装测试填平补齐技术改造项目	--	--	1,537.60	384.40	1,922.00	根据南通市财政局、南通市工业和信息化局《关于下达 2020 年度市区产业转型升级专项资金工业项目（第批）部分结项尾款的通知》（通财工贸【2020】64 号），公司“集成电路封装测试填平补齐技术改造项目”收到补助款。
智能芯片圆片级基板扇出型封装（FOPoS）技术研发及产业化	--	1,600.00	--	300.00	1,900.00	根据江苏省财政厅和江苏省科学技术厅《江苏省财政厅江苏省科学技术厅关于下达 2019 年省科技成果转化专项资金的通知》（苏财教【2019】104 号）、《江苏省财政厅江苏省科学技术厅关于下达 2021 年省科技相关专项资金（第一批）的通知》（苏财教（2021）19 号），公司收到省科技成果转化专项资金补助款。
2021 年第一批核心产业专项资金	--	--	--	1,800.00	1,800.00	公司申请的《苏州工业园区核心产业发展资金》，经苏州工业园区投资促进局审批，收到投促委 2021 年第一批核心产业专项资金中的先进设备投资扶持。
2017 年度第二批市区	--	1,681.00	--	--	1,681.00	根据南通市经济和信息化委员会南通市财政局《关于下达 2017 年

项目名称	到账时间、金额（万元）					取得依据
	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-9 月	合计	
工业企业技术改造项目						市区工业专项项目资金的通知》（通经信发【2019】9号），公司符合相关补助条件并收到2017年度市区第二批工业企业技术改造项目补助资金。
安徽省科学技术厅 02 项目专项资金	752.22	765.54	--	--	1,517.76	根据上海市科学技术委员会《关于拨付极大规模集成电路制造装备及成套工艺科技重大专项 2017 年中央财政预算经费的函》（沪科【2017】394 号），合肥通富承担“12 吋国产中道装备金凸块制造与晶元测试新工艺开发与应用”及“12 吋国产中道装备金凸块制造与晶元测试工艺开发”两项课题取得相关补助。
国家进口贴息项目-3	--	1,512.96	--	--	1,512.96	根据南通市财政局《关于下达 2019 年省商务发展专项资金（第四批）预算指标的通知》（通财工贸【2019】49 号），南通市财政局拨付公司补助款。
苏通二期第一阶段扩大投资奖励 0001471 号土地补助	--	1,280.00	--	--	1,280.00	根据南通市苏通工业园区相关通知，南通苏通科技产业园区财政局拨付公司苏通二期第一阶段扩大投资奖励款。
三期项目投资奖励	--	--	--	1,280.00	1,280.00	公司向江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会提出落实工业用地项目投资的奖金申请，并取得相关财政拨款
智能移动终端集成电路封装测试生产线扩能技改项目	--	--	988.80	247.20	1,236.00	根据南通市财政局、南通市工业和信息化局《关于下达 2020 年度市区产业转型升级专项资金工业项目（第批）部分结项尾款的通知》（通财工贸【2020】64 号），公司收到“智能移动终端集成电路封装测试生产线扩能技改项目”补助款。
政府贷款贴息和研发费用奖励	--	1,070.06	--	--	1,070.06	根据南通苏通科技产业园区党工委、管委会办公室办文单《关于南通通富微电子有限公司贷款贴

项目名称	到账时间、金额（万元）					取得依据
	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-9 月	合计	
						息、研发费用奖励的申请》 （【2019】103 号）文件，公司收到江苏南通苏通科技产业园区财政局拨付的补助款。
3DNAND 闪存超薄芯片多叠层产品封装技术开发及产业化	919.13	--	139.42	--	1,058.55	根据“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室《关于同意“3DNAND 闪存超薄芯片多叠层产品封装技术开发及产业化”任务增加联合承担单位的通知》、《极大规模集成电路制造装备及成套工艺科技重大专项预算拆分报告》及南通市科学技术局和财政局 2018 年 12 月 29 日发布的《关于下达 2018 年度第一批世级科技计划项目和财政资助科技经费（含分年度与省以上匹配）的通知》通科计【2018】152 号，公司承担 3DNAND 闪存超薄芯片多叠层产品封装技术开发及产业化项目并取得相关补助。
2019 年国家进口贴息项目	--	--	1,012.17	--	1,012.17	根据苏财工【2020】70 号，公司收到商务部发展专项资金；根据《关于下达 2020 年省商务发展专项资金（第四、五批）预算指标的通知》（通财工贸【2020】56 号），公司收到“2019 年国家进口贴息”补助款。
重点项目建设奖励	--	500.00	500.00	--	1,000.00	根据安徽省人民政府《安徽省人民政府关于印发支持集成电路产业加快创新发展若干政策的通知》（皖政【2018】94 号）、《安徽省经济和信息化厅安徽省发展和改革委员会安徽省财政厅关于印发支持集成电路产业加快创新发展若干政策实施细则的通知》（皖经信电子【2019】37 号）文件，公司收到合肥财政厅拨付的重点项目补奖励款。
2016 年度第二批市区工	1,000.00	--	--	--	1,000.00	根据南通市经济和信息化委员会南通市财政局 2017 年 8

项目名称	到账时间、金额（万元）					取得依据
	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-9 月	合计	
业企业技术改造项目						月 18 号（通经信发【2017】143 号）《关于下达 2016 年市区首台套、新接订单等工业项目专项资金的通知》，公司取得相关项目补助。
核心产业投资补助-2019 年设备投资	--	--	1,000.00	--	1,000.00	自贸区制度创新局拨付核心产业发展资金补助款。
核心产业投资补助-2018 年设备投资	--	--	1,000.00	--	1,000.00	自贸区制度创新局拨付核心产业发展资金补助款。
苏通一期项目扩大投资奖励 03050062 号土地补助	--	--	995.58	--	995.58	根据南通市苏通工业园区相关通知，江苏南通苏通科技产业园区财政局拨付公司一期项目扩大投资奖励。
经发委 2018 年苏州工业园区 技术改造	--	920.30	--	--	920.30	因公司承担《2017 集成电路测试设备技术改造项目》，苏州工业园区行政审批局向公司拨付园区转型升级专项资金（技术改造项目）。
经发委 2017 年园区转型升级 专项资金 （技术改造 项目）第一 批	897.00	--	--	--	897.00	根据苏园管（2017）25 号园区管委会关于印发《关于促进苏州工业园区企业技术改造的若干意见》的通知，公司收到经济发展委员会拨付的 2017 年园区转型升级专项资金。
发 改 委 20172018 年区级工业 经济发展扶 持政策资金	--	--	820.58	--	820.58	根据南通市崇川区发展和改革委员会和南通市崇川区财政局《关于申请拨付 2017、2018 年区级工业经济发展扶持政策资金的请示》（崇川发改发【2020】6 号）文件，公司收到南通市崇川区财政局拨付的发改委 2017、2018 年区级工业经济发展扶持资金。
经发委（投 促局）2019	-	800.00	--	--	800.00	苏州工业园区投资促进局、苏州工业园区经济发展委员会根据

项目名称	到账时间、金额（万元）					取得依据
	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-9 月	合计	
年第二批核心产业						《苏州工业园区关于鼓励和发展核心产业的若干意见》和《苏州工业园区核心产业发展资金管理办法》的规定，公司收到 2019 年第二批申报项目的扶持奖励。
核心产业投资补助-研发补助	--	--	800.00	--	800.00	收到自贸区制度创新局 2020 年第一批核心产业发展资金。
其他-二期项目投资奖励	--	--	--	640.00	640.00	公司向江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会提出落实工业用地项目投资的奖金申请，收到财政拨款。
经发委 2019 年度产业转型升级（技术改造）专项资金	--	--	547.42	--	547.42	公司收到经发委 2019 年度产业转型升级（技术改造）专项资金。
2018 年度工业强基设备购置额 8% 补助	500.00	--	--	--	500.00	根据财政部《财政部关于核定科技重大专项 2009 年立项项目（课题）中央财政资金预算并下达 2009 年年度预算的通知》（财教〔2009〕479 号）、江苏省科学技术厅苏科计【2011】294 号文，江苏省科学技术厅《关于拨付国家“集成电路”科技重大专项立项项目 2014 年国拨经费的通知》（苏科技发【2014】192 号）文，公司承担相关项目并取得补助。
发改委 2016 区级工业经济发展经济扶持资金	435.80	--	--	--	435.80	根据南通市崇川区发展和改革委员会《关于下达 2016 年区级工业经济发展扶持资金的通知》（崇川发改发【2018】44 号）文件，公司收到发改委拨付的企业提速扩规模项目应税销售奖励。
企业失业保险稳岗返还款	--	479.25	--	--	479.25	根据省人社厅、省财政厅、省发改委、省经信办《安徽省关于开展失业保险稳岗返还工作的通知》皖人社秘【2019】166 号文件，公司收到企业失业保险稳岗

项目名称	到账时间、金额（万元）					取得依据
	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-9 月	合计	
						返还款。
科 信 局 2019 年 第 八 批 20190 园 区 科 技 和 信 息 化 局 2018 年 度 企 业 研 发 投 入 补 助 资 金	--	433.40	--	--	433.40	根据《苏州工业园区科技创新能力提升实施细则》苏园科（2018）21号文件，公司收到研发投入补助资金。
南通财政局 付贷款贴息	--	326.25	--	--	326.25	公司收到南通市崇川区财政局关于银行贷款贴息补助款。
收外贸促进 政策（稳外 贸 激 励 政 策）资金	--	--	--	366.60	366.60	2020年省级外贸促进政策（稳外贸激励政策项目）资金。
合计：	14,537.08	12,507.07	15,542.82	5,018.20	47,605.17	

根据企业会计准则相关规定，公司对上述政府补助的具体核算情况如下：

单位：万元

分类	所属年度	补助到账金 额（1）	计入当期损 益的金额 （2）	报告期内 递延收益 增减净额 （3=1-2）	政府补助计入当期损益或递延收益的 划分标准、依据
02 专项补 助	2018 年度	11,704.28	4,571.52	267.12	国家级重大的综合性政府补助。公司承担 02 专项相关研发任务，02 专项的补助范围包括资产购置成本及研发相关的费用支出。公司收到补助款后计入递延收益，根据补助的性质及项目研发进展情况结转计入当期损益。
	2019 年度	1,903.85	7,745.06		
	2020 年度	2,904.55	2,605.92		
	2021 年 1-9 月	--	1,323.06		
	小计：	16,512.68	16,245.56		
园区拨付 财政奖励	2018 年度	--	--	--	非项目补助，公司不承担具体任务，主要是政府相关部门对公司生产经营的扶持奖励，收到补助后当期全额计入损益。
	2019 年度	--	--		
	2020 年度	3,436.12	3,436.12		
	2021 年 1-9 月	--	--		
	小计：	3,436.12	3,436.12		
集 成 电 路 封 装 测 试 填 平 补 齐	2018 年度	--	--	1,757.83	与公司设备投入、项目建设相关的补助。公司收到补助款后计入递延收益，项目建设形成相关长期资产后，分期
	2019 年度	--	--		
	2020 年度	1,537.60	16.02		

技术改造 项目	2021年1-9月	384.40	148.15		结转计入当期损益。
	小计:	1,922.00	164.17		
智能芯片 圆片级基 板扇出型 封装 (FOPoS) 技术研发 及产业化	2018年度	--	--	1,900.00	与公司设备投入、项目建设相关的补 助。公司收到补助款后计入递延收益， 项目建设形成相关长期资产后，分期 结转计入当期损益。
	2019年度	1,600.00	--		
	2020年度	--	--		
	2021年1-9月	300.00	--		
	小计:	1,900.00	--		
2021年第 一批核心 产业专项 资金-补偿 费用支出	2018年度	--	--	--	非项目补助，公司不承担具体任务， 主要是政府相关部门对公司生产经营 的扶持奖励，收到补助后当期全额计 入损益。
	2019年度	--	--		
	2020年度	--	--		
	2021年1-9月	800.00	800.00		
	小计:	800.00	800.00		
2021年第 一批核心 产业专项 资金-补偿 设备支出	2018年度	--	--	875.00	与公司设备投入、项目建设相关的补 助。公司收到补助款后计入递延收益， 项目建设形成相关长期资产后，分期 结转计入当期损益。
	2019年度	--	--		
	2020年度	--	--		
	2021年1-9月	1,000.00	125.00		
	小计:	1,000.00	125.00		
2017年度 第二批市 区工业企 业技术改 造项目	2018年度	--	--	1,190.71	与公司设备投入、项目建设相关的补 助。公司收到补助款后计入递延收益， 项目建设形成相关长期资产后，分期 结转计入当期损益。
	2019年度	1,681.00	122.57		
	2020年度	--	210.13		
	2021年1-9月	--	157.59		
	小计:	1,681.00	490.29		
国家进口 贴息项目	2018年度	-	--	1,166.24	与公司设备投入、项目建设相关的补 助。公司收到补助款后计入递延收益， 项目建设形成相关长期资产后，分期 结转计入当期损益。
	2019年度	1,512.96	15.76		
	2020年度	--	189.12		
	2021年1-9月	--	141.84		
	小计:	1,512.96	346.72		
苏通二期 第一阶段 扩大投资 奖励 0001471号 土地补助	2018年度	--	--	1,137.07	公司收到补助款后计入递延收益，在 土地使用权年限内分期结转计入当期 损益。
	2019年度	1,280.00	98.13		
	2020年度	--	25.60		
	2021年1-9月	--	19.20		
	小计:	1,280.00	142.93		
三期项目 投资奖励	2018年度	-	--	1,262.28	公司收到补助款后计入递延收益，在 土地使用权年限内分期结转计入当期 损益。
	2019年度	--	--		
	2020年度	--	--		
	2021年1-9月	1,280.00	17.72		

	小计:	1,280.00	17.72		
智能移动终端集成电路封装测试生产线扩能技改项目	2018 年度	--	--	1,130.42	与公司设备投入、项目建设相关的补助。公司收到补助款后计入递延收益，项目建设形成相关长期资产后，分期结转计入当期损益。
	2019 年度	--	--		
	2020 年度	988.80	10.30		
	2021 年 1-9 月	247.20	95.28		
	小计:	1,236.00	105.58		
政府贷款贴息和研发费用奖励	2018 年度	--	--	--	非项目补助，公司不承担具体任务，主要是政府相关部门对公司生产经营的扶持奖励，收到补助后当期全额计入损益。
	2019 年度	1,070.06	1,070.06		
	2020 年度	--	--		
	2021 年 1-9 月	--	--		
	小计:	1,070.06	1,070.06		
2019 年国家进口贴息项目	2018 年度	--	--	690.65	与公司设备投入、项目建设相关的补助。公司收到补助款后计入递延收益，项目建设形成相关长期资产后，分期结转计入当期损益。
	2019 年度	--	--		
	2020 年度	1,012.17	168.13		
	2021 年 1-9 月	--	153.39		
	小计:	1,012.17	321.52		
重点项目建设奖励	2018 年度	--	--	817.71	与公司设备投入、项目建设相关的补助。公司收到补助款后计入递延收益，项目建设形成相关长期资产后，分期结转计入当期损益。
	2019 年度	500.00	20.83		
	2020 年度	500.00	67.71		
	2021 年 1-9 月	--	93.75		
	小计:	1,000.00	182.29		
2016 年度第二批市区工业企业技术改造项目	2018 年度	1,000.00	83.33	572.92	与公司设备投入、项目建设相关的补助。公司收到补助款后计入递延收益，项目建设形成相关长期资产后，分期结转计入当期损益。
	2019 年度	--	125.00		
	2020 年度	--	125.00		
	2021 年 1-9 月	--	93.75		
	小计:	1,000.00	427.08		
核心产业投资补助-2019 年设备投资	2018 年度	--	--	562.50	与公司设备投入、项目建设相关的补助。公司收到补助款后计入递延收益，项目建设形成相关长期资产后，分期结转计入当期损益。
	2019 年度	--	--		
	2020 年度	1,000.00	250.00		
	2021 年 1-9 月	--	187.50		
	小计:	1,000.00	437.50		
核心产业投资补助-2018 年设备投资	2018 年度	--	--	416.67	与公司设备投入、项目建设相关的补助。公司收到补助款后计入递延收益，项目建设形成相关长期资产后，分期结转计入当期损益。
	2019 年度	--	--		
	2020 年度	1,000.00	333.33		
	2021 年 1-9 月	--	250.00		
	小计:	1,000.00	583.33		
苏通一期	2018 年度	--	--	854.30	公司收到补助款后计入递延收益，在

项目扩大 投资奖励 03050062 号土地补 助	2019 年度	--	--		土地使用权年限内分期结转计入当期 损益。
	2020 年度	995.58	126.32		
	2021 年 1-9 月	--	14.96		
	小计:	995.58	141.28		
经 发 委 2018 年苏 州工业园 区技术改 造	2018 年度	--	--	306.76	与公司设备投入、项目建设相关的补 助。公司收到补助款后计入递延收益， 项目建设形成相关长期资产后，分期 结转计入当期损益。
	2019 年度	920.30	306.77		
	2020 年度	--	306.77		
	2021 年 1-9 月	--	--		
	小计:	920.30	613.54		
经 发 委 2017 年园 区转型升 级专项资 金(技术改 造项目)第 一批	2018 年度	897.00	299.00	--	与公司设备投入、项目建设相关的补 助。公司收到补助款后计入递延收益， 项目建设形成相关长期资产后，分期 结转计入当期损益。
	2019 年度	--	299.00		
	2020 年度	--	299.00		
	2021 年 1-9 月	--	--		
	小计:	897.00	897.00		
发 改 委 2017 2018 年区级工 业经济发 展扶持政 策资金	2018 年度	--	--	--	非项目补助，公司不承担具体任务， 主要是政府相关部门对公司生产经营 的扶持奖励，收到补助后当期全额计 入损益。
	2019 年度	--	--		
	2020 年度	820.58	820.58		
	2021 年 1-9 月	--	--		
	小计:	820.58	820.58		
经发委(投 促局)2019 年第二批 核心产业	2018 年度	--	--	--	非项目补助，公司不承担具体任务， 主要是政府相关部门对公司生产经营 的扶持奖励，收到补助后当期全额计 入损益。
	2019 年度	800.00	800.00		
	2020 年度	--	--		
	2021 年 1-9 月	--	--		
	小计:	800.00	800.00		
核 心 产 业 投资补助- 研发补助	2018 年度	--	--	--	非项目补助，公司不承担具体任务， 主要是政府相关部门对公司生产经营 的扶持奖励，收到补助后当期全额计 入损益。
	2019 年度	--	--		
	2020 年度	800.00	800.00		
	2021 年 1-9 月	--	--		
	小计:	800.00	800.00		
二 期 项 目 投资奖励	2018 年度	--	--	630.54	公司收到补助款后计入递延收益，在 土地使用权年限内分期结转计入当期 损益。
	2019 年度	--	--		
	2020 年度	--	--		
	2021 年 1-9 月	640.00	9.46		
	小计:	640.00	9.46		
经 发 委 2019 年度	2018 年度	--	--	307.92	与公司设备投入、项目建设相关的补 助。公司收到补助款后计入递延收益，
	2019 年度	--	--		

产业转型升级(技术改造)专项资金	2020年度	547.42	136.86		项目建设形成相关长期资产后,分期结转计入当期损益。
	2021年1-9月	--	102.64		
	小计:	547.42	239.50		
2018年度工业强基设备购置额8%补助	2018年度	500.00	62.50	265.63	与公司设备投入、项目建设相关的补助。公司收到补助款后计入递延收益,项目建设形成相关长期资产后,分期结转计入当期损益。
	2019年度	--	62.50		
	2020年度	--	62.50		
	2021年1-9月	--	46.87		
	小计:	500.00	234.37		
发改委2016区级工业经济发展经济扶持资金	2018年度	435.80	435.80	--	非项目补助,公司不承担具体任务,主要是政府相关部门对公司生产经营的扶持奖励,收到补助后当期全额计入损益。
	2019年度	--	--		
	2020年度	--	--		
	2021年1-9月	--	--		
	小计:	435.80	435.80		
企业失业保险稳岗返还款	2018年度	--	--	--	非项目补助,公司不承担具体任务,主要是政府相关部门对公司生产经营的扶持奖励,收到补助后当期全额计入损益。
	2019年度	479.25	479.25		
	2020年度	--	--		
	2021年1-9月	--	--		
	小计:	479.25	479.25		
科信局2019年第八批20190园区科技和信息化局2018年度企业研发投入补助资金	2018年度	--	--	--	非项目补助,公司不承担具体任务,主要是政府相关部门对公司生产经营的扶持奖励,收到补助后当期全额计入损益。
	2019年度	433.40	433.40		
	2020年度	--	--		
	2021年1-9月	--	--		
	小计:	433.40	433.40		
南通财政局付贷款贴息	2018年度	--	--	--	非项目补助,公司不承担具体任务,主要是政府相关部门对公司生产经营的扶持奖励,收到补助后当期全额计入损益。
	2019年度	326.25	326.25		
	2020年度	--	--		
	2021年1-9月	--	--		
	小计:	326.25	326.25		
外贸促进政策(稳外贸激励政策)资金	2018年度	--	--	--	非项目补助,公司不承担具体任务,主要是政府相关部门对公司生产经营的扶持奖励,收到补助后当期全额计入损益。
	2019年度	--	--		
	2020年度	--	--		
	2021年1-9月	366.60	366.60		
	小计:	366.60	366.60		
合计		47,605.17	33,191.98	14,413.19	

（三）公司政府补助计入经常性损益和非经常性损益的划分标准、依据和金额

根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》的规定：非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。

报告期内，公司计入当期损益的政府补助虽与经营业务相关，但均不属于按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助，由于其性质、金额或发生频率具有不确定性，因此全部计入非经常性损益。

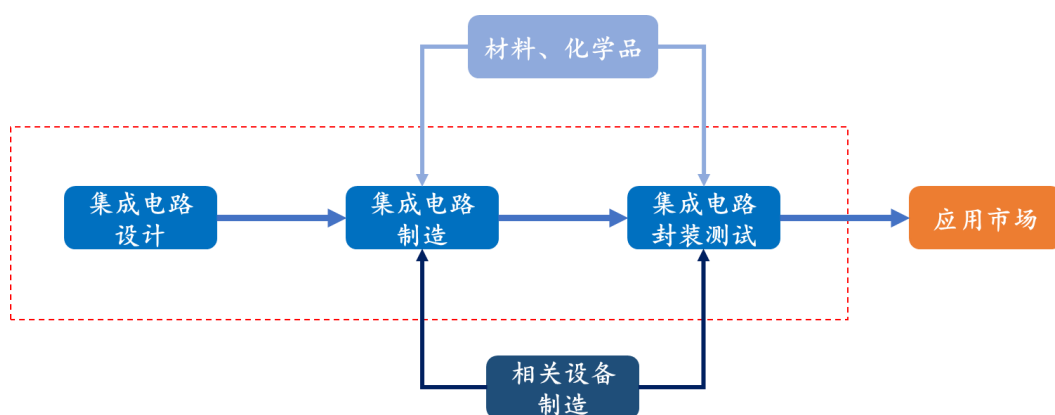
二、按业务类别说明公司所处行业全产业链（包括上下游各个环节）的简要情况，包括但不限于业务流程、市场容量、市场竞争等，并结合前述情况说明报告期内业绩波动的合理性，收入变动和净利润变动的匹配性，是否与同行业公司变动趋势一致；

（一）集成电路全产业链的简要情况

1、集成电路产业链结构

按照集成电路制造的业务流程划分，集成电路核心产业链主要由集成电路设计、集成电路晶圆制造、集成电路封装测试三个环节组成。集成电路设计是集成电路的开发过程，即通过系统设计和电路设计形成设计版图的过程。集成电路完成设计环节后进入集成电路制造环节。集成电路制造是指将光掩模上的电路图形信息大批量复制到晶圆上，并在晶圆上大批量形成特定集成电路结构的过程，其技术含量高、工艺复杂，在芯片生产过程中处于至关重要的地位。集成电路制造完毕后进入封装测试环节。封装是指将加工完成后的晶圆（芯片）经切割后之晶粒，以塑料、陶磁、金属等材料被覆，以保护晶粒避免受到外界污染。测试是指在完成封装后对集成电路的功能、电参数进行测量，以筛选出不合格的产品，并通过测试结果来发现芯片设计、制造及封装过程中的质量缺陷。集成电路完成封装测试后即销售给整机生产厂商，应用于计算机、通信、消费电子、汽车电子、工业、新能源等领域。与此同时，半导体材料和半导体设备是集成电路产业的主要支撑产业。

集成电路产业链结构图示如下：



2、集成电路设计行业简介

集成电路设计行业位于集成电路产业链上游，属于技术密集型产业，具有技术门槛高、产品附加值高、细分品类多等特点。集成电路下游应用领域的不断延展和技术的快速进步推动了芯片设计行业的快速发展。

我国集成电路设计行业市场规模持续增长。根据中国半导体行业协会统计数据，2015-2020年中国芯片设计行业销售规模从1,325亿元增长到3,778亿元，年均复合增长率达到23.32%，增长速度较快。

按地域来看，目前全球集成电路设计产业仍然以美国企业为主导，近年来中国大陆企业的竞争力快速增强，市场地位逐步上升，但与国际知名厂商相比，在高端芯片设计能力、经营规模、盈利水平等方面仍存在较大的追赶空间。根据芯途研究院统计数据，2020年全球收入规模前十大集成电路设计公司中有6家美国公司，前三名分别是高通、博通以及英伟达，均为美国企业。中国台湾地区的联发科、联咏科技和瑞昱半导体分别排名第四、第八和第九位。近年来，国内涌现出一批在细分领域竞争力较强的芯片设计行业上市公司，包括卓胜微、汇顶科技、士兰微等。虽然我国集成电路设计行业保持着快速发展的态势，但是行业整体实力不强，行业集中度较低。

3、集成电路制造行业简介

集成电路制造行业在产业链中具有关键地位。在集成电路产业链各个环节中，制造环节的价值量最大，同时毛利率也处于行业较高水平。随着“无晶圆制

造的设计公司（Fabless）+晶圆代工厂（Foundry）+封装测试代工企业（OSAT）”的垂直分工模式成为主流趋势，晶圆代工厂在整个产业链中的重要程度也逐步提升，产能的输出主要由集成电路制造企业所掌控。

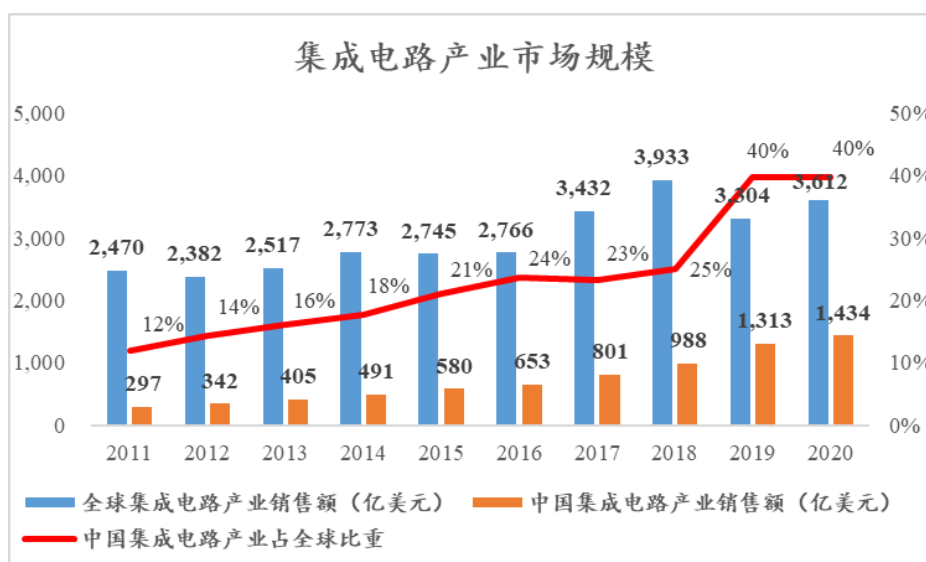
据 IC Insights 统计，2020 年全球晶圆代工行业市场规模约为 677 亿美元，2013 年至 2020 年的复合增长率为 9.36%。全球集成电路制造行业市场集中度较高，呈现非常明显的头部效应。根据 TrendForce 统计数据，全球前十大晶圆代工厂商中，台积电一家占据了超过一半的市场份额，前十大晶圆代工企业合计市场份额已超过 90%。中国大陆晶圆代工企业中，市场份额最大的是中芯国际，市场份额达到 18%，全球排名第 5；华虹半导体的市场份额约为 1%，排名第 9。

4、集成电路行业及封测行业的市场容量

（1）全球集成电路产业市场容量

根据 WSTS 统计，从 2011 年到 2018 年，全球集成电路市场规模从 2,470 亿美元迅速提升至 3,933 亿美元，年均复合增长率为 6.87%。2018 年下半年，受全球宏观经济增速放缓以及智能手机销售量下降等因素的影响，全球电子行业需求疲软，半导体行业作为电子行业上游基础性产业，市场也随之出现下降。

2019 年下半年至今，存储器、高性能计算、5G 通信、物联网、数据中心、汽车电子等领域快速发展。随着下游产业需求逐渐回暖，全球半导体产业恢复增长，行业景气度显著回升。2020 年全球集成电路市场规模达到 3,612 亿美元，同比增长 9.32%。



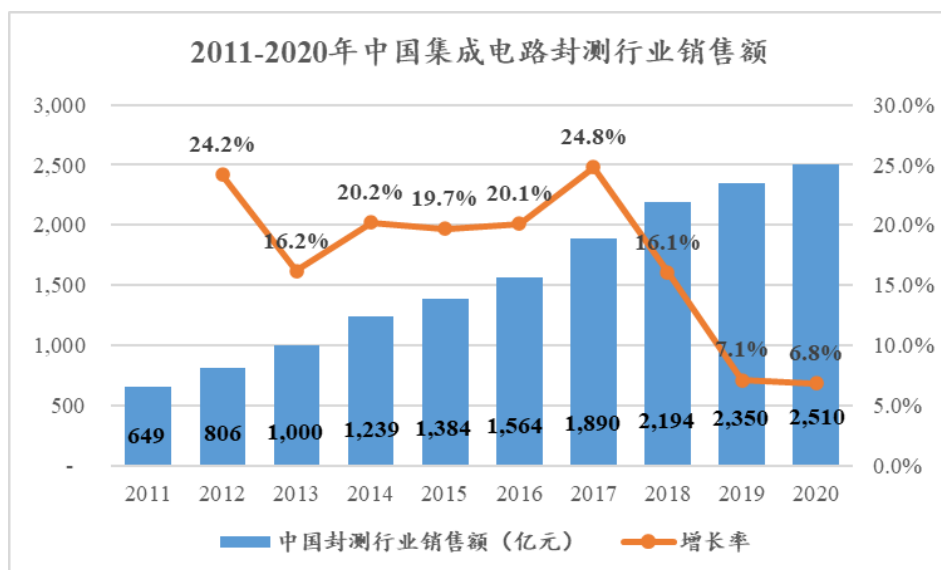
数据来源：根据 WSTS、IC Insight、中商产业研究院数据整理

(2) 中国集成电路产业市场容量

基于巨大的市场需求、稳定的经济增长以及有利的产业政策环境等众多优势条件，中国目前已成为全球最大的集成电路市场，成为带动全球集成电路市场增长的主要动力。根据中国半导体行业协会统计数据，从 2011 年到 2020 年中国集成电路市场规模从 1,934 亿元扩大至 8,848 亿元，年均复合增长率为 18.41%，明显高于同期全球集成电路市场的增速。同时，中国集成电路产业销售额占全球市场的比重持续增长，2020 年占比达到 40%，中国已成为全球最大、增速最快的集成电路市场。2021 年 1-9 月，中国集成电路产业销售额为 6,859 亿元，同比增长 16.1%，市场规模继续保持快速增长。

(3) 中国集成电路封测市场容量

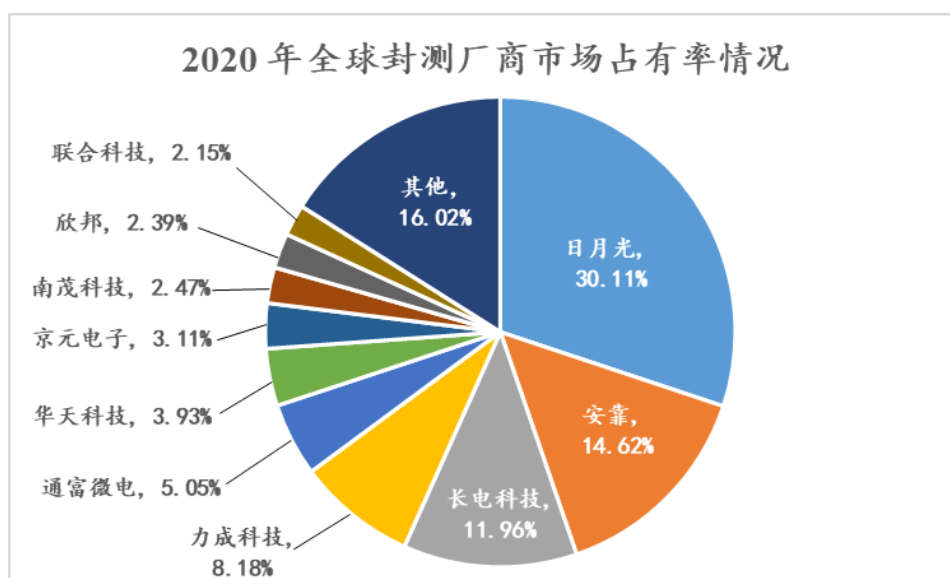
中国大陆在封装测试领域具备成本优势和地缘优势，目前已经成为全球第二大的封装测试基地。近年来，随着国家对半导体行业的扶持力度持续增强，以及国内终端厂商逐渐将集成电路供应链向国内转移；同时受益于 5G 的快速推广和普及，以物联网、人工智能、云计算、新能源汽车为代表的新兴领域对芯片的需求不断上升，在集成电路行业整体高速增长的带动下，我国封装测试行业亦呈现出持续增长的态势，市场规模从 2011 年的 649 亿元增长至 2020 年的 2,510 亿元，年均复合增长率 16.22%。2021 年 1-9 月，中国集成电路封装测试行业销售额为 1,850 亿元，同比增长 8.1%，市场规模继续保持平稳增长。



数据来源：中国半导体行业协会（CSIA）

5、集成电路封装测试行业的市场竞争格局

从全球范围来看，经过多年的发展，集成电路封装测试行业已涌现出一批竞争力较强的企业，行业整体集中度较高，且呈现持续上升的趋势。根据芯思想研究院统计数据，2020年全球前10大封装测试代工企业（OSAT）的销售规模合计占全球市场规模的比例已超过80%。



数据来源：根据芯思想研究院数据整理

日月光、安靠等国际领先的封装测试厂商已掌握先进封装测试技术，拥有强大的技术研发实力、先进的生产设备和成熟的生产工艺，且资金实力雄厚，具有较强的竞争优势，尤其是在经营规模方面优势明显。同时，经过多年的发展和实践，中国大陆企业通富微电目前已跻身国际封装测试企业第一阵营，2020年全

球市场份额达到 5.05%，成为全球第五大封装测试企业，同时在技术方面已与国际先进水平并行发展。

从区域格局来看，中国台湾、中国大陆和美国形成了三足鼎立的局面。2020 年中国台湾的市场份额超过 45%，排名行业第一，在前十大封测厂商中占据 5 个席位，分别为日月光、力成科技、京元电子、南茂科技和硕邦；中国大陆近年来实现了快速发展，市场份额逐渐提升，2020 年已超过 20%，在前十大封测厂商中占据 3 个席位，分别为长电科技、通富微电和华天科技；美国的市场份额超过 10%，在前十大封测厂商中占据 1 个席位（安靠）。

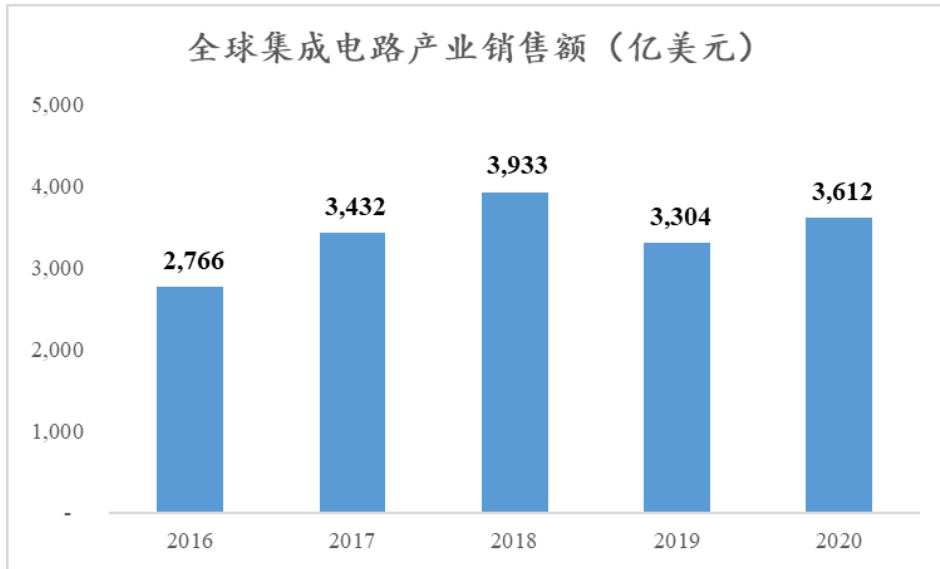
（二）报告期内发行人业绩波动的合理性、收入变动与净利润变动的匹配性

1、报告期内公司营业收入变动与行业发展趋势一致

报告期内，发行人营业收入主要来源于以集成电路封装测试为主营业务的收入。2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月，公司实现营业收入分别为 722,286.30 万元、826,657.46 万元、1,076,870.00 万元和 1,120,360.64 万元。2018 年至 2020 年，公司营业收入的复合增长率为 22.10%，2021 年 1-9 月营业收入同比增长 51.00%。公司主营业务稳步、快速增长的主要原因如下：

（1）下游终端应用需求强劲，集成电路行业市场需求旺盛

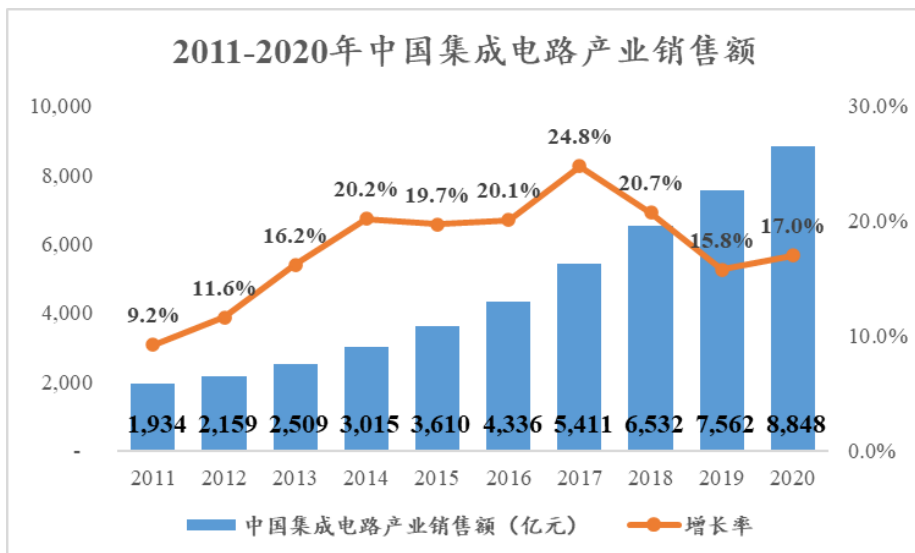
2018 年至今，受益于 4G、5G 通信业务的快速发展以及新能源汽车、家电、显示平板、物联网、电脑、路由器和 AI 等终端应用需求的提升，集成电路行业市场需求持续旺盛，近三年全球集成电路产业市场规模一直在 3,300 亿美元以上，为公司发展提供了广阔的市场空间。



数据来源: WSTS

(2) 集成电路行业国产化替代需求增强

随着经济的不断发展,我国已成为全球最大的电子产品生产及消费市场,衍生出了巨大的半导体需求。自 2018 年中美贸易摩擦以来,国家进一步重视集成电路产业的发展,国内晶圆制造企业不断扩产,集成电路设计企业借助国产化春风加速成长。作为国内技术领先的封测企业,公司紧抓时代机遇,进一步加强与卓胜微、韦尔股份、艾为电子、兆易创新、博通集成等国内知名企业的深度合作,来自境内的收入呈高速增长态势。



数据来源: 中国半导体行业协会 (CSIA)

（3）公司核心客户发展势头强劲

发行人是面向全球的集成电路封测企业，报告期内，公司主要客户销售规模高速扩张，对公司高端封测产品的采购量增加。公司核心客户包括 AMD、MTK、意法半导体、德州仪器、英飞凌等，均为全球知名的半导体企业，经营规模大，市场影响力强。报告期内，公司与上述客户保持了良好的合作关系，上述客户的快速发展为公司收入持续增长提供了重要支撑。

AMD 和 MTK 是公司报告期内的前两大客户，公司来自 AMD 和 MTK 的收入占比超过 50%，两家核心客户在报告期内业绩增长迅速。AMD 为全球领先的高性能处理器设计公司。近年来，AMD 凭借“先进架构+先进制程”双管齐下，借助台积电实现对英特尔先进制程的赶超，在全球 CPU 市场的份额稳步提升。2020 年，AMD 实现营业收入 97.6 亿美元，同比增长 45%。MTK 在 5G 时代借力中国手机品牌，在中端手机市场取得成功，市场占有率赶超高通，成为全球手机芯片的龙头。2020 年，MTK 销售收入增长至 110 亿美元，同比增长 30%。

（4）凭借行业内领先的技术优势，持续扩大市场影响力

作为全球知名的封测企业，公司紧跟行业尖端技术发展，不断通过经验积累和研发投入，提升产品性能，配套客户需求。公司在先进封装技术（Bumping、WLCSP、FC、FCBGA、SiP 等）领域已与国际先进同行并行发展；在 QFN、QFP、SO 等传统封装技术以及汽车电子产品、MEMS 等领域亦拥有深厚的技术积累。同时，公司已具备 7 纳米、晶圆级封装、存储器芯片、Driver IC 等新产品的技术及量产能力。紧跟行业发展趋势、实现技术突破是公司不断扩大市场影响力、持续拓展客户的坚实基础。

综上，报告期内，集成电路下游终端应用市场需求强劲；集成电路产业国产化进程持续向前推进；公司核心客户经营业绩快速增长，封测需求大幅上升；同时公司凭借自身技术和产品优势不断扩大市场影响力。因此，发行人营业收入变动与行业发展趋势相符。

2、发行人营业收入持续增长，净利润受毛利率、期间费用率的影响而有所波动

报告期内，发行人营业收入和净利润变动情况具体如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度
	金额	变化率	金额	变化率	金额	变化率	金额
营业收入	1,120,360.64	51.00%	1,076,870.00	30.27%	826,657.46	14.45%	722,286.30
净利润	71,649.08	142.06%	38,851.05	937.62%	3,744.25	-75.53%	15,303.14

注：表格中的变化率均为同比数据。

2019年度，公司营业收入较2018年度有所增长，但净利润有所下降，主要原因系毛利率下降，同时公司期间费用率上升，具体分析如下：

（1）毛利率下降

2019年，受宏观经济增长放缓及中美贸易摩擦的影响，全球集成电路行业的景气度有所下降。公司2019年毛利率相比2018年下降2.23个百分点，下降幅度相对较大的原因系：①公司2019年固定资产增加较快，折旧增加。2019年末，公司固定资产原值较2018年末增加205,375.76万元，2019年度折旧与摊销增加20,225.48万元；②自2018年下半年开始，半导体行业景气度明显下降，在行业整体趋势下行的大背景下，公司积极通过调整产品结构、客户结构等方式抢抓订单、开拓市场，导致毛利率较低的产品销售比例有所增加，对综合毛利率造成了一定不利影响；③2019年，在国产替代的大背景下，公司境内收入占比提升，国内客户在产品需求、技术先进性及价格敏感度方面与境外客户存在差异，当期来自国内客户的毛利率略低；④公司产品构成中，先进封装产品占比较高，该类产品生产所需的基板类原材料采购价格在2019年有所上升，公司生产成本增加，一定程度上拉低了产品销售的毛利率。

（2）期间费用率上升

由于2019年度发行人财务费用及研发费用增加，导致期间费用率上升，具体如下：

①财务费用增加

2019年度，发行人母公司、南通通富及合肥通富持续投产，此外通富超威苏州及通富超威槟城为应对AMD的7纳米芯片封装需求，设备投资加大，营运资金需求增加。发行人2019年末银行借款余额增加203,039.30万元，当年利息

支出增加 5,022.79 万元。此外，受外币汇率变动影响，发行人 2019 年度汇兑收益较 2018 年度减少 4,769.27 万元。受前述因素影响，发行人 2019 年度财务费用较 2018 年度增加 11,066.28 万元。

②研发费用增加

2019 年度发行人研发费用较 2018 年度增加 12,604.71 万元，主要原因系受行业特性影响，在行业技术日新月异发展的大背景下，为提升我国半导体封测技术水平，同时夯实技术优势为公司后续发展提供有力支撑，发行人持续增加研发投入。2019 年与 2018 年相比，公司完成的研发项目以及处于开发阶段的研发项目数量均有所增长，同时随着技术先进性的提升，单个项目的研发投入要求更高。

因此，2019 年公司营业收入增长但净利润有所下降主要系毛利率下降和期间费用率上升所致。

2020 年，在集成电路产业国产化的大背景下，5G、物联网、人工智能等新兴应用领域的快速发展带动集成电路市场需求逐步提升，行业景气度显著回升。受益于经济内循环和集成电路国产化浪潮，公司国内客户订单明显增加；同时，以 AMD、MTK 为代表的国际大客户市场占有率提升，订单需求增长强劲。在多重利好的驱动下，2020 年公司营业收入快速增长。另一方面，在市场需求持续旺盛的同时，受海外疫情影响，半导体行业整体产能紧张，封测企业议价能力提升，产品毛利率相应上升。在上述两个因素影响下，2020 年公司净利润大幅提升。

2021 年以来，集成电路终端应用领域的需求保持强劲态势，全球晶圆代工厂持续进行扩产，同时集成电路国产化进程进一步向前推进，使封测行业市场需求进一步释放，公司产销两旺，营业收入、产品毛利率进一步提升。2021 年 1-9 月，公司经营业绩大幅增加，盈利能力也有所提升。

综上，报告期内，发行人营业收入呈逐年增长趋势；2019 年度公司净利润下降主要原因系毛利率下降，同时公司期间费用率上升所致；2020 年度及 2021 年 1-9 月，受益于集成电路终端应用市场需求增长及国产化浪潮持续推进，行业景气度显著提高，公司营业收入与净利润均大幅上涨，变化趋势一致。因此，发行人收入变动和净利润变动具有匹配性。

3、发行人经营业绩与同行业公司变动趋势基本一致

报告期内，发行人与同行业可比公司营业收入、净利润变化对比情况具体如下：

单位：万元

公司	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度
	金额	变化率	金额	变化率	金额	变化率	金额
营业收入							
长电科技	2,191,711.52	16.81%	2,646,399.45	12.49%	2,352,627.98	-1.38%	2,385,648.74
华天科技	886,708.13	49.85%	838,208.42	3.44%	810,349.06	13.79%	712,170.63
发行人	1,120,360.64	51.00%	1,076,870.00	30.27%	826,657.46	14.45%	722,286.30
净利润							
长电科技	211,655.03	176.62%	130,598.39	1,251.28%	9,664.77	110.43%	-92,664.05
华天科技	126,975.39	145.49%	82,019.20	180.01%	29,291.41	-31.76%	42,923.71
发行人	71,649.08	142.06%	38,851.05	937.62%	3,744.25	-75.53%	15,303.14

注：表格中的变化率均为同比数据。

报告期内，发行人与华天科技的经营业绩变动趋势一致，两者营业收入均呈现逐年增长的趋势。2019年度，受半导体行业周期波动、市场整体需求大幅下降的影响，发行人与华天科技的净利润均有所下滑；2020年度及2021年1-9月，发行人与华天科技的净利润均大幅上升，变动趋势一致。

报告期内，长电科技2019年度的营业收入略有下降，主要原因系其通过转让子公司江阴新顺微电子有限公司和深圳长电科技有限公司的股权，剥离了分立器件自销业务相关资产，相关业务收入下降。2020年度及2021年1-9月，发行人与长电科技的营业收入均有所增长，变动趋势一致。2019年度，长电科技净利润增长110.43%，根据其披露的年度报告，主要原因系其财务费用由2018年的113,102.51万元下降到2019年的87,011.26万元，下降23.07%；同时资产减值损失由2018年的54,692.00万元下降到2019年的23,392.88万元，资产处置收益由2018年的-520.09万元增加到2019年的74,348.04万元，因此净利润大幅提升。2020年度及2021年1-9月，发行人与长电科技的净利润均有所增长，变动趋势一致。

综上，报告期内发行人与华天科技的经营业绩变动趋势一致；2019年度发行人与长电科技的经营业绩变动趋势存在差异，主要原因系长电科技剥离了分立

器件自销业务相关资产,同时财务费用、资产减值损失减少且资产处置收益增加,2020年度及2021年1-9月,发行人与长电科技的经营业绩变动趋势相同。

三、结合同行业可比上市公司对比情况分析报告期内主营业务毛利率波动的原因及合理性,并说明毛利率波动对持续盈利能力的影响,相关风险是否充分披露。

公司与同行业上市公司的综合毛利率对比分析情况如下:

公司名称	股票代码	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
长电科技	600584.SH	17.85%	15.46%	10.43%	11.43%
华天科技	002185.SZ	25.56%	21.68%	16.33%	16.32%
平均		21.71%	18.57%	13.38%	13.88%
发行人	002156.SZ	18.78%	15.47%	13.67%	15.90%

注:上述可比公司数据取自可比公司定期报告及wind数据库。

(一) 公司与同行业可比公司毛利率差异分析

报告期内,公司综合毛利率与可比公司平均毛利率的差异较小。公司综合毛利率略高于长电科技,略低于华天科技,整体差异较小。毛利率的差异主要系由各公司间产品结构差异、客户差异、生产管理差异等产生,具有合理性。

报告期内,公司综合毛利率整体略高于长电科技。2020年及2021年1-9月,公司与长电科技毛利率差异较小。2018年、2019年,长电科技毛利率略低于公司主要系:长电科技2015年收购STATS ChipPAC Pte. Ltd(星科金朋),2016年至2019年处于并购整合期,产能利用率相对较低,业绩亏损,对长电科技整体毛利率造成一定影响。

报告期内,华天科技的毛利率高于公司,主要原因系:①公司与华天科技的具体产品销售结构、客户群体存在差异。②华天科技传统封装基地位于西部地区的甘肃天水,在人工、动力等成本方面具有一定比较优势。根据华天科技2020年年度报告披露:“公司总部位于我国西部的甘肃省天水市,同位于东部沿海发达地区的同行业企业相比,在动力成本、土地成本、人力成本等方面具有一定的竞争优势。”

(二) 公司与同行业公司毛利率变动趋势分析

报告期内，公司综合毛利率与行业平均毛利率及其变动趋势基本保持一致。

2019年，长电科技综合毛利率相比2018年下降1个百分点，华天科技毛利率相对稳定，公司2019年综合毛利率相比2018年下降2.23个百分点，下降幅度相对较大的原因系：①公司2019年固定资产增加较快，折旧增加。2019年末，公司固定资产原值较2018年末增加205,375.76万元，2019年度折旧与摊销增加20,225.48万元；②2019年，在国产替代的大背景下，公司境内收入占比提升，国内厂商在产品需求、先进程度及价格敏感度方面有不同要求，当期来自国内客户的毛利率略低；③公司产品构成中，先进封装产品占比较高，该类产品生产所需的基板类原材料采购价格2019年有所上升，生产成本增加，一定程度上拉低了产品销售的毛利率。

2020年、2021年1-9月，受市场需求增长、产能利用率提升的影响，公司及同行业公司毛利率均呈上升趋势，具体分析如下：

(1) 市场需求快速增长，主要封测厂商的销售收入增长迅速。2020年以来，随着5G、物联网、新能源车、人工智能等新兴应用领域市场快速发展，半导体行业下游需求快速上升。需求端快速增长的同时，叠加全球疫情对境外封测企业产能的影响，导致国内半导体行业整体产能稀缺。供需错配下国内封测行业持续高景气，龙头厂商订单饱和，产品议价能力提升。报告期内，公司及同行业公司的营业收入变动情况如下：

单位：亿元

公司名称	2021年1-9月		2020年度		2019年度		2018年度
	金额	增速	金额	增速	金额	增速	金额
长电科技	219.17	16.81%	264.64	12.49%	235.26	-1.38%	238.56
华天科技	88.67	49.85%	83.82	3.44%	81.03	13.79%	71.22
发行人	112.04	51.00%	107.69	30.27%	82.67	14.45%	72.23

(2) 市场需求旺盛、产能利用率提升带来的规模效应。受益于行业需求的提升，集成电路封测行业2020年以来的产品销售量增长迅速。产销量快速增长有利于各封测厂商发挥规模效应，降低单位成本。

根据长电科技 2020 年 12 月的公开披露信息：“2019 年下半年以来，半导体行业景气度回升，芯片终端应用市场从 4G 向 5G 产品的迭代进入增长期，带动行业迅速发展。”“在营业收入及产能利用率的提升下，公司毛利率由 2019 年度的 11.18% 上升至 15.46%（2020 年 1-9 月）”。

根据华天科技 2020 年年度报告，“2020 年集成电路市场景气度较 2019 年大幅提升，公司订单饱满，净利润创历史新高。”根据华天科技 2021 年 8 月公开披露信息，2018 年、2019 年、2020 年，华天科技集成电路封装产能利用率分别为 87.91%、90.93%、94.83%，呈不断上升趋势。

综上所述，公司报告期内毛利率变动趋势与行业变动趋势一致，2018 年、2019 年毛利率相对较低，2020 年以来，受益于行业需求的快速扩张及产能利用率的提升，国内集成电路封测行业的主要企业毛利率呈上升趋势。

（三）毛利率波动对持续盈利能力的影响及相关风险的披露

2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月，发行人综合毛利率分别为：15.90%、13.67%、15.47% 和 18.78%，呈现一定的波动。报告期内，公司销售净利率分别为：2.12%、0.45%、3.61% 和 6.40%。由于公司销售净利率相对较低，如果公司综合毛利率降低，那么将会对公司净利润产生较大的影响。2019 年，受集成电路行业景气度下降、公司固定资产折旧增加、原材料成本上升等因素影响，公司综合毛利率下降 2.23 个百分点，导致公司当期净利润下降 75.53%。2020 年以来，受行业景气度提升、产品订单增长、议价能力增强、产能利用率提升等因素影响，公司毛利率呈上升趋势，导致公司 2020 年、2021 年 1-9 月的净利润分别同比增长 937.62%、142.06%。

由于公司毛利率波动对公司经营业绩的影响较大，如果公司毛利率降低，则会使公司产生业绩下滑的风险。公司已修订本次发行预案，补充披露发行人“主营业务毛利率下降的风险”，具体如下：

“公司主营业务主要为集成电路的封装测试，主营业务毛利率对公司经营业绩影响较大。2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月，发行人主营业务毛利率分别为 15.56%、12.70%、15.01% 和 18.78%，呈现一定的波动。报告期内，公司净利润受主营业务毛利率影响也有一定幅度波动。如果未来行业需求发生变

化，市场竞争加剧或公司技术无法满足客户需求或公司设备折旧、人工成本、原材料成本等大幅上升，可能会导致公司订单数减少或产品价格下降或生产成本上升，进而导致主营业务毛利率下降，将会对公司经营业绩产生不利影响。”

四、核查情况

（一）核查程序

保荐机构和申报会计师履行了如下核查程序：

1、获取公司三年一期财务报表，分析公司利润表各项目变动的原因，核查公司综合毛利率的主要影响因素，公司固定资产的各期变动情况，公司的主要客户构成，主要原材料的采购金额和采购单价等。

2、了解、评价和测试与销售、采购相关的关键内部控制设计和运行的有效性；检查主要客户和供应商的合同、发票、银行回单等原始单据。

3、获取公司的销售费用、管理费用、财务费用、研发费用明细表，分析各项费用的具体构成情况，抽样核查费用发生的真实性、完整性。获取公司各期的研发项目明细，核查研发费用变动的原因。

4、获取公司各期的非经常性损益明细表，检查政府补助文件、银行回单等原始单据，并结合文件内容判断政府补助分类是否准确，分摊是否合理；对非经常性损益进行重新计算，并于公司计算的结果进行对比。

5、查阅发行人以及同行业可比公司披露的年度报告等公开资料，对比发行人与同行业公司经营业绩的变化趋势；查阅同行业可比公司长电科技、华天科技各期毛利率变动的原因，核查公司毛利率与可比公司差异的原因，以及毛利率变动趋势的一致性。

（二）核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司 2019 年扣非后净利润大幅亏损主要系：（1）由于折旧规模上升、市场景气度下行、客户结构和产品结构调整以及部分原材料价格上升等因素影响，

公司主营业务毛利率下降；（2）当期研发费用和财务费用增加，导致期间费用率上升。

2、2019年，公司非经常性损益较大主要系当期取得的政府补助增加。

3、公司对收到的政府补助的会计处理符合会计准则的要求。公司各期确认的政府补助全部计入非经常性损益。

4、报告期内发行人营业收入变动与行业发展趋势一致；发行人收入变动和净利润变动具有匹配性；发行人与华天科技的经营业绩变动趋势一致，2019年度与长电科技的经营业绩变动趋势存在差异，主要原因系长电科技剥离了分立器件自销业务相关资产，同时财务费用、资产减值损失减少且资产处置收益增加，2020年度及2021年1-9月，发行人与长电科技的经营业绩变动趋势相同。

5、公司毛利率变动与行业内可比上市公司毛利率变动趋势基本一致，公司毛利率与长电科技毛利率差异较小，与华天科技的毛利率差异具有合理性。

6、公司已在修订的发行预案中补充披露主营业务毛利率下降的风险。

经核查，会计师认为：“我们没有发现公司上述回复中与财务报告相关的信息与我们在审计过程中获取的相关资料在所有重大方面存在不一致。我们认为，2019年扣非后净利润大幅亏损及非经常性损益金额较大具有合理性；政府补助计入当期损益或递延收益、计入经常性损益和非经常性损益的划分标准、依据和金额具有合理性；报告期内业绩波动具有合理性，收入变动和净利润变动与同行业公司变动趋势一致；报告期内主营业务毛利率波动具有合理性，公司已就毛利率波动对持续盈利能力的影响及相关风险进行充分披露。”

问题 2、关于厦门通富

据申报材料，2017 年 8 月通富微电与厦门半导体投资集团有限公司以货币形式出资，合作成立厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”），通富微电持有厦门通富 10% 股权。申请人及其附属公司的对外担保如下：

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	已签署合同担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否提供反担保
厦门通富	2018/08/11	12,000.00	2018/11/30	11,200.00	连带责任保证	2019.02.27-2029 02.26	是

请申请人说明并披露：（1）通富微电为厦门通富提供担保的背景、原因及合理性，厦门通富的其他股东是否为厦门通富提供担保，如否，原因及合理性；（2）提供担保的决策审批程序，独立董事的意见，相关反担保措施是否可行。请保荐机构、申请人律师说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。

回复：

一、通富微电为厦门通富提供担保的背景、原因及合理性，厦门通富的其他股东是否为厦门通富提供担保，如否，原因及合理性

（一）发行人为厦门通富提供担保的背景、原因及合理性

2018 年 11 月 30 日，发行人持股 10% 的参股公司厦门通富因生产经营需要向国家开发银行（下称“国开行”）借款，签订编号为 3520201801100000811 的《借款合同》，约定借款金额为 120,000.00 万元，贷款期限 10 年。

作为厦门通富的股东，为促进厦门通富更好的经营发展，使得股东获得更好的投资收益，发行人及另外持股 90% 的股东厦门半导体投资集团有限公司（以下简称“厦门半导体”）的股东厦门海沧投资集团有限公司（以下简称“厦门海投”）及厦门海沧旅游投资集团有限公司（以下简称“厦门海旅”）分别作出内部决策文件，决定支持厦门通富为正常开展经营活动所需，向国开行进行上述借款。发行人按照 10% 的股权比例提供担保，厦门海投和厦门海旅按照他们分别间接持有的厦门通富股比提供担保。

基于上述背景及原因，发行人依法经内部决策后，作出为厦门通富上述债务的 10% 向国开行提供担保的决定，并于 2018 年 11 月 30 日与国开行签署了相应《保证合同》。

（二）厦门半导体的全体股东已按照其对厦门半导体的持股比例为厦门通富上述借款提供相应担保

2018 年 11 月 30 日，厦门海投和厦门海旅作为厦门半导体的股东，与发行人一并和国开行签订了（3520201801100000811 号借款合同的保证合同）《国家开发银行保证合同》，约定厦门海投就被担保债务的 47.817% 向国开行提供担保、厦门海旅就被担保债务的 42.183% 向国开行提供担保、发行人就被担保债务的 10% 向国开行提供担保。

2019 年 3 月 19 日，厦门通富的另外持股 90% 的股东厦门半导体进行了股东变更：原股东之一厦门海旅变更为厦门海沧发展集团有限公司（以下简称“厦门海发”）。2020 年 3 月 4 日，厦门海发召开第一届董事会 2020 年第五次会议，同意配合厦门海投向贷款人国开行推动变更保证人事宜，按照厦门海发、厦门海投分别间接持有厦门通富股比 63%、27% 的实际情况，调整厦门通富该项债务的担保比例。

因厦门半导体股东变更，2020 年 10 月 15 日，厦门海发、厦门海投以及发行人与国家开发银行厦门市分行签订了（3520201801100000811 号借款合同的保证合同之二）《国家开发银行保证合同》，约定厦门海发就被担保债务的 63% 向国开行提供担保、厦门海投就被担保债务的 27% 向国开行提供担保、发行人就被担保债务的 10% 向国开行提供担保。保证人均按约定的保证份额提供连带责任保证。保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

二、提供担保的决策审批程序，独立董事的意见，相关反担保措施是否可行

（一）发行人上述对外担保执行的决策审批程序

公司制定了《经济担保制度》，对发生对外担保行为时的担保对象、审批权限、决策程序、信息披露等作了明确规定。发行人关于上述对外担保所执行的审批程序如下：

2018年8月10日，发行人第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股10%的子公司厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）向国家开发银行申请综合授信贷款额度人民币13.4亿元，按照公司10%的股权比例所对应的担保范围提供全程连带责任保证担保。

2018年8月28日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股子公司厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）向国家开发银行（以下简称“国开行”）申请的13.4亿元人民币授信贷款，按照公司10%的股权比例提供担保。

2018年11月30日，发行人为上述担保事宜签署《保证合同》，根据《保证合同》和编号为3520201801100000811的《借款合同》（下称“主合同”）约定，被担保债务为主合同项下厦门通富向国开行借款12亿元人民币（贷款期限自2019年2月27日至2029年2月26日止）的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金和贷款人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、公证费、律师费及其他费用）；及厦门通富根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。

《保证合同》约定，发行人为上述被担保债务的10%向国开行提供担保。保证方式为连带责任保证。保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

截至2021年9月30日，公司实际为厦门通富1.2亿元借款提供了担保。

（二）发行人独立董事意见

2018年8月10日，发行人独立董事发表了《通富微电子股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见》：公司为参股公司厦门通富提供担保，主要为其开展正常经营活动所需，可以促进其更好经营发展并获得更好的投资收益，符合公司整体利益，且公司和其他股东相关方

采取同比例提供担保。该对外担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及广大股东利益的情形，同意公司本次为参股公司厦门通富提供担保事宜。

此后，发行人独立董事分别于 2019 年 3 月 28 日、2020 年 3 月 27 日、2021 年 3 月 29 日和 2021 年 8 月 26 日就发行人上述对外担保事项持续发表独立意见：认为公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。报告期内，公司对外担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司报告期无违规对外担保的情形。

综上，发行人独立董事就发行人为厦门通富提供担保一事已发表独立意见，认为发行人上述对外担保具有合理性，相关审批程序符合有关法律法规的要求，

（三）反担保措施及可行性

2020 年 2 月 21 日，发行人第六届董事会第十四次会议审议通过了控股股东华达微向公司提供反担保暨关联交易的议案，由华达微就前述贷款事项向发行人提供反担保。发行人控股股东华达微符合《深圳证券交易所股票上市规则》对关联法人的规定，与此有关联关系的董事石明达董事、石磊董事以及夏鑫董事进行了回避。

2020 年 3 月 9 日，发行人 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东华达微替代参股子公司厦门通富向公司提供反担保暨关联交易的议案》。

2020 年 2 月 21 日，华达微作为反担保人出具了《反担保承诺函》，同意以反担保人身份为发行人为厦门通富承担的担保责任提供反担保。反担保人承诺对通富微电为厦门通富向国开行申请的人民币 13.4 亿元综合授信贷款在 10% 股权比例所对应的全部担保债权承担连带保证责任，保证期间为：自通富微电履行担保义务之次日起三年。

据发行人提供的华达微近三年《审计报告》，报告期内，发行人控股股东华达微单体报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年度/2020年末	2019年度/2019年末	2018年度/2018年末
资产总额	303,411.97	252,950.79	227,024.08
净资产	281,083.87	215,501.38	191,120.64
资产负债率	7.36%	14.81%	15.81%
营业收入	37,445.51	34,605.55	37,674.84
净利润	14,938.95	11,905.81	3,286.86

根据上表显示，报告期内华达微总资产、净资产规模逐年攀升，盈利状况良好，资产负债率保持在较低水平，具有持续盈利能力，华达微的净资产规模远高于本次担保的金额。根据发行人及华达微说明，并经保荐机构和申请人律师适当核查相关网站网址及征信报告，截至本回复出具日，华达微未发生无法偿还或延期偿还借款的情形，具有一定反担保承担能力。

三、核查情况

（一）核查程序

保荐机构及申请人律师履行了如下核查程序：

- 1、查阅了发行人所签订的投资协议；
- 2、取得了发行人对外担保对应的主债权合同、担保合同及反担保合同；查询了被担保人、反担保人和担保权人的工商信息，取得反担保人的《审计报告》、征信报告，并进行相关网络核查；
- 3、查阅了发行人履行相关决策程序的文件；查阅了发行人定期报告及相关信息披露公告、独立董事意见等；
- 4、取得并查阅了控股股东出具的《反担保承诺函》。

（二）核查结论

经核查，保荐机构和申请人律师认为：

- 1、发行人为厦门通富提供的担保具有合理性；

2、厦门半导体的全体股东已按照其分别间接持有的厦门通富股比为厦门通富上述借款提供相应担保；

3、发行人提供担保的决策履行了相应的审批程序，独立董事对该担保事项发表了明确意见；

4、发行人控股股东华达微进行了反担保承诺，其具有一定反担保承担能力。

问题 3、关于“存贷双高”

报告期内，申请人货币资金余额分别为 137,283.38 万元、222,469.49 万元、412,099.73 万元和 530,149.46 万元；短期借款余额分别为 239,346.3 万元、429,776.05 万元、356,389.26 万元和 333,812.46 万元；长期借款余额为 36,079.96 万元、75,809.56 万元、244,881.21 万元及 385,928.37 万元。

请申请人：（1）按账户列示报告期银行存款、其他货币资金的存放情况，说明是否存在存单质押、与控股股东资金池担保等使用受限情形；（2）说明在货币资金较为充裕情况下，短期借款及长期借款余额较高的原因及合理性。请保荐机构、申报会计师说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。

回复：

一、按账户列示报告期银行存款、其他货币资金的存放情况，说明是否存在存单质押、与控股股东资金池担保等使用受限情形。

公司报告期各期末货币资金具体构成如下表所示：

单位：万元

项 目	2021.09.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
库存现金	0.48	0.61	0.36	0.84
银行存款	365,937.30	282,398.23	200,996.57	123,578.95
其他货币资金	60,012.09	129,700.89	21,472.56	13,703.59
合 计	425,949.87	412,099.73	222,469.49	137,283.38
其中：受限资金	55,512.09	15,607.83	21,472.56	13,703.59
不受限资金	370,437.79	396,491.90	200,996.93	123,579.79

公司货币资金由库存现金、银行存款、其他货币资金构成，其中：库存现金主要用于公司零星开支；银行存款主要用于公司日常经营所需资金支付，如向供应商支付采购货款、采购设备、支付人员工资、缴纳税费、支付费用、支付借款本金及利息、支付信用证保证金等；其他货币资金主要为信用证、保函、银行承兑汇票等相关业务的保证金及定期存款等。

（一）报告期大额银行存款存放情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司银行存款余额为 365,937.30 万元，其中大额银行存款（余额 500 万元及以上）存放情况如下：

存放主体	开户行	金额（万元）	存放方式	是否受限
通富微电	工行南通分行营业部	11,712.31	活期	否
通富微电	工行南通分行营业部	5,962.09	活期	否
通富微电	中行南通分行营业部	5,287.59	活期	否
通富微电	中行南通分行营业部	2,175.10	活期	否
通富微电	中行南通分行营业部	2,571.84	活期	否
通富微电	江苏银行南通崇川支行	1,824.82	活期	否
通富微电	江苏银行南通崇川支行	2,155.39	活期	否
通富微电	交通银行南通台商支行	1,778.33	活期	否
通富微电	交通银行南通分行	1,197.37	活期	否
通富微电	建行南通崇川支行	4,286.23	活期	否
通富微电	建行南通崇川支行	3,461.22	活期	否
通富微电	建行南通崇川支行	16,466.09	活期	否
通富微电	建行南通崇川支行	7,508.49	活期	否
通富微电	浦发银行南通分行	3,160.36	活期	否
通富微电	浦发银行南通分行	837.50	活期	否
通富微电	浦发银行南通分行	926.09	活期	否
通富微电	民生银行南通分行	1,011.77	活期	否
通富微电	农行南通分行营业部	1,602.07	活期	否
通富微电	华夏银行南通分行	516.70	活期	否
通富微电	华夏银行南通分行	1,396.34	活期	否
通富微电	招商银行南通分行	2,032.94	活期	否
通富微电	招商银行南通分行	832.75	活期	否
通富微电	中信银行南通分行	5,435.28	活期	否
通富微电	汇丰银行南通分行	3,787.19	活期	否
通富微电	浙商银行南通分行	696.39	活期	否
通富微电	浙商银行南通分行	568.85	活期	否
通富微电	浙商银行南通分行	1,433.56	活期	否
通富微电	汇丰银行南通分行	850.08	活期	否
通富微电	国家开发银行江苏省分行	1,029.16	活期	否
通富微电	平安银行南通分行	1,435.14	活期	否
通富微电	平安银行南通分行	713.70	活期	否
通富微电	苏州银行南通分行	1,176.32	活期	否
通富微电	宁波银行南京分行	2,417.83	活期	否
通富微电	星展银行（中国）有限公司苏州分行	1,067.20	活期	否

通富微电	北京银行南通分行	501.34	活期	否
通富微电	广发银行南通分行	2,895.57	活期	否
通富微电	光大银行南通分行	1,281.54	活期	否
通富微电	中国银行南通分行	548.83	活期	否
通富超威苏州	中国银行苏州工业园区支行	1,905.33	活期	否
通富超威苏州	中国银行苏州工业园区支行	5,675.74	活期	否
通富超威苏州	中国银行苏州工业园区支行	12,691.32	活期	否
通富超威苏州	中国农业银行姑苏支行	66,111.83	活期	否
通富超威苏州	中国建设银行苏州分行营业部	528.32	活期	否
通富超威槟城	美国银行（马来西亚）	689.33	活期	否
通富超威槟城	美国银行（马来西亚）	61,098.21	活期	否
通富超威槟城	汇丰银行槟城分行	683.71	活期	否
通富超威槟城	马来西亚银行	13,115.53	活期	否
通富超威槟城	豐隆銀行有限公司	701.92	活期	否
南通通富	中国银行南通分行	893.37	活期	否
南通通富	中国银行南通分行	730.07	活期	否
南通通富	中国建设银行南通崇川支行	1,445.97	活期	否
南通通富	国家开发银行江苏省分行	17,077.76	活期	否
南通通富	国家开发银行江苏省分行	1,596.62	活期	否
南通通富	国家开发银行江苏省分行	14,665.62	活期	否
南通通富	国家开发银行江苏省分行	18,900.00	活期	否
南通通富	国家开发银行江苏省分行	4,951.04	活期	否
南通通富	国家开发银行江苏省分行	5,571.17	活期	否
通富科技	建行南通崇川支行	1,846.21	活期	否
合肥通富	工行合肥自贸区支行	567.55	活期	否
合肥通富	中行合肥开发区支行	1,828.55	活期	否
合肥通富	中行合肥开发区支行	602.45	活期	否
合肥通富	中行合肥开发区支行	623.13	活期	否
合肥通富	农行合肥分行	3,001.12	活期	否
合肥通富	中信银行合肥滨湖支行	501.14	活期	否
合肥通富	国家开发银行安徽分行	882.02	活期	否
海耀实业	交通银行香港分行	6,585.10	活期	否
海耀实业	花旗银行上海分行	5,605.05	活期	否
合计		355,616.55		
占银行存款余额比例		97.18%		

截至 2020 年 12 月 31 日，公司银行存款余额为 282,398.23 万元，其中大额银行存款（余额 500 万元及以上）存放情况如下：

存放主体	开户行	金额（万元）	存放方式	是否受限
------	-----	--------	------	------

通富微电	中国银行南通分行	5,825.94	活期	否
通富微电	工行南通分行	14,176.40	活期	否
通富微电	工行南通分行	6,450.54	活期	否
通富微电	中国银行南通分行	2,033.74	活期	否
通富微电	中国银行南通分行	12,030.54	活期	否
通富微电	中国银行南通分行	1,929.09	活期	否
通富微电	中国银行南通分行	2,160.95	活期	否
通富微电	江苏银行南通崇川支行	1,303.14	活期	否
通富微电	江苏银行南通崇川支行	1,188.54	活期	否
通富微电	交通银行城东支行	20,543.06	活期	否
通富微电	交通银行南通分行营业部	1,817.23	活期	否
通富微电	中国建设银行南通市城东支行	2,249.27	活期	否
通富微电	中国建设银行南通崇川支行	1,286.30	活期	否
通富微电	中国建设银行南通崇川支行	6,248.49	活期	否
通富微电	上海浦东发展银行南通分行	1,527.17	活期	否
通富微电	中国农业银行南通分行营业部	3,872.10	活期	否
通富微电	中国农业银行南通分行营业部	581.30	活期	否
通富微电	比利时联合银行上海分行	573.75	活期	否
通富微电	华夏银行南通分行	1,023.96	活期	否
通富微电	兴业银行南通分行营业部	6,335.74	活期	否
通富微电	招商银行南通分行	530.43	活期	否
通富微电	中国进出口银行南京分行	2,419.47	活期	否
通富微电	中信银行南通分行	3,844.51	活期	否
通富微电	中信银行南通分行	3,901.47	活期	否
通富微电	汇丰银行南通分行	512.12	活期	否
通富微电	汇丰银行南通分行	1,186.95	活期	否
通富微电	浙商银行南通分行	933.74	活期	否
通富微电	恒丰银行南通分行	854.93	活期	否
通富微电	平安银行南通分行	4,141.34	活期	否
通富微电	宁波银行南京分行	2,862.44	活期	否
通富微电	星展银行（中国）有限公司苏州分行	1,562.46	活期	否
通富微电	北京银行南通分行营业部	500.22	活期	否
通富微电	广发银行南通分行营业部	5,000.00	活期	否
海耀实业	交通银行香港分行	9,169.66	活期	否
海耀实业	花旗银行	6,349.04	活期	否
南通通富	中国银行南通分行	731.20	活期	否
南通通富	国家开发银行江苏省分行	11,043.20	活期	否
南通通富	国家开发银行江苏省分行	1,679.54	活期	否

南通通富	国家开发银行江苏省分行	15,767.29	活期	否
南通通富	国家开发银行江苏省分行	18,900.00	活期	否
南通通富	国家开发银行江苏省分行	14,178.21	活期	否
合肥通富	中国银行合肥经济技术开发区支行	2,463.94	活期	否
合肥通富	中国银行合肥经济技术开发区支行	3,083.31	活期	否
通润达	中国银行南通分行	1,565.83	活期	否
通富超威苏州	中国银行苏州工业园区分行	7,307.76	活期	否
通富超威苏州	中国银行苏州工业园区分行	2,067.26	活期	否
通富超威苏州	中国农业银行苏州姑苏支行	5,191.96	活期	否
通富超威槟城	美国银行吉隆坡分行	1,529.48	活期	否
通富超威槟城	建设银行吉隆坡分行	16,312.25	活期	否
通富超威槟城	马来亚银行	33,929.48	活期	否
合计		272,676.74		
占银行存款余额比例		96.56%		

截至 2019 年 12 月 31 日，公司银行存款余额为 200,996.57 万元，其中大额银行存款（余额 500 万元及以上）存放情况如下：

存放主体	开户行	金额（万元）	存放方式	是否受限
通富超威槟城	建设银行吉隆坡分行	14,663.67	活期	否
通富超威槟城	美国银行吉隆坡分行	927.52	活期	否
合肥通富	国家开发银行安徽省分行	24,771.08	活期	否
合肥通富	中国工商银行合肥明珠支行	3,777.71	活期	否
合肥通富	中国银行合肥经济开发区支行	1,110.53	活期	否
南通通富	国家开发银行江苏省分行	41,000.86	活期	否
南通通富	中国银行南通分行	623.60	活期	否
通富超威苏州	中国工商银行苏州工业园区支行	4,275.12	活期	否
通富超威苏州	中国农业银行苏州姑苏支行	3,357.53	活期	否
通富超威苏州	中国银行苏州工业园区分行营业部	6,318.98	活期	否
通润达公司	中国银行南通分行	1,770.52	活期	否
海耀实业	花旗银行（中国）有限公司上海分行	6,265.45	活期	否
海耀实业	交通银行香港分行	5,264.83	活期	否
通富微电	比利时联合银行股份有限公司上海分行	916.65	活期	否

通富微电	恒丰银行股份有限公司南通分行	912.90	活期	否
通富微电	华夏银行股份有限公司南通分行	1,179.78	活期	否
通富微电	汇丰银行(中国)有限公司南通分行	3,795.64	活期	否
通富微电	江苏银行股份有限公司南通崇川支行	1,900.52	活期	否
通富微电	交通银行南通分行台商投资开发区支行	10,675.97	活期	否
通富微电	平安银行股份有限公司南通分行	1,327.48	活期	否
通富微电	上海浦东发展银行南通分行	1,688.45	活期	否
通富微电	苏州银行股份有限公司南通分行	2,396.97	活期	否
通富微电	招商银行股份有限公司南通分行	1,015.44	活期	否
通富微电	浙商银行股份有限公司南通分行	2,320.71	活期	否
通富微电	中国工商银行江苏省南通分行	9,555.78	活期	否
通富微电	中国建设银行南通崇川支行	615.78	活期	否
通富微电	中国建设银行南通市城东支行	578.26	活期	否
通富微电	中国进出口银行江苏省分行	21,979.04	活期	否
通富微电	中国民生银行股份有限公司南通分行	8,935.12	活期	否
通富微电	中国农业银行南通分行营业部	1,797.93	活期	否
通富微电	中国银行南通分行	5,131.45	活期	否
通富微电	中信银行股份有限公司南通分行	6,475.83	活期	否
合计		197,327.10		
占银行存款余额比例		98.17%		

截至 2018 年 12 月 31 日，公司银行存款余额为 123,578.95 万元，其中大额银行存款（余额 500 万元及以上）存放情况如下：

存放主体	开户行	金额（万元）	存放方式	是否受限
通富超威槟城	建设银行吉隆坡分行	3,451.80	活期	否
通富超威槟城	美国银行吉隆坡分行	2,043.05	活期	否
合肥通富	国家开发银行安徽省分行	32,772.58	活期	否
合肥通富	中国工商银行合肥明珠支行	3,002.78	活期	否
合肥通富	中国银行合肥经济开发区支行	5,119.60	活期	否
南通通富	国家开发银行江苏省分行	1,116.63	活期	否
南通通富	兴业银行南通分行营业部	1,774.84	活期	否

南通通富	中国建设银行南通崇川支行	539.64	活期	否
通富超威苏州	中国农业银行苏州姑苏支行	684.06	活期	否
通富超威苏州	中国银行苏州工业园区分行营业部	913.25	活期	否
通富微电	比利时联合银行股份有限公司上海分行	766.26	活期	否
通富微电	渤海银行股份有限公司南通分行	501.26	活期	否
通富微电	恒丰银行股份有限公司南通分行	897.66	活期	否
通富微电	汇丰银行（中国）有限公司南通分行	1,070.94	活期	否
通富微电	江苏银行股份有限公司南通崇川支行	765.09	活期	否
通富微电	交通银行南通分行台商投资开发区支行	7,990.43	活期	否
通富微电	平安银行股份有限公司南通分行	3,284.25	活期	否
通富微电	上海浦东发展银行南通分行	873.88	活期	否
通富微电	苏州银行股份有限公司南通分行	783.35	活期	否
通富微电	兴业银行股份有限公司南通分行	871.10	活期	否
通富微电	招商银行股份有限公司南通分行	926.14	活期	否
通富微电	浙商银行股份有限公司南通分行	7,012.92	活期	否
通富微电	中国工商银行江苏省南通分行	1,012.31	活期	否
通富微电	中国建设银行南通市崇川支行	1,702.11	活期	否
通富微电	中国进出口银行江苏省分行	3,592.73	活期	否
通富微电	中国民生银行股份有限公司南通分行	1,618.71	活期	否
通富微电	中国农业银行南通分行营业部	594.96	活期	否
通富微电	中国银行南通分行	19,772.43	活期	否
通富微电	中信银行股份有限公司南通分行	3,240.16	活期	否
通润达公司	中国银行南通分行	2,043.76	活期	否
海耀实业	花旗银行（中国）有限公司上海分行	6,787.32	活期	否
海耀实业	交通银行香港分行	3,112.02	活期	否
合计		120,638.02		
占银行存款余额比例		97.62%		

（二）报告期其他货币资金存放情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司其他货币资金余额为 60,012.09 万元，其中 4,500.00 万元为定期存款，剩余为信用证保证金等受限资金。具体存放情况如下：

存放主体	开户行	金额（万元）	是否受限
通富微电	招商银行南通分行	4,500.00	定期存款，不受限
通富微电	江苏银行南通崇川支行	135.45	信用证保证金，受限
通富微电	建行南通崇川支行	26,350.00	信用证保证金，受限
通富微电	农行南通分行营业部	412.23	信用证保证金，受限
通富微电	交通银行南通分行	400.00	信用证保证金，受限
通富微电	兴业银行南通分行	17.10	信用证保证金，受限
通富微电	浙商银行南通分行	3,013.39	信用证保证金，受限
通富微电	中国银行南通分行营业部	6,354.33	信用证保证金，受限
南通通富	中国建设银行南通崇川支行	1,930.00	信用证保证金，受限
南通通富	交通银行南通城东支行	2,362.00	信用证保证金，受限
南通通富	招商银行南通分行	7,515.50	信用证保证金，受限
通富科技	中行南通分行营业部	4,700.49	信用证保证金，受限
合肥通富	建行合肥经开区支行	200.00	保函保证金，受限
合肥通富	建行合肥经开区支行	1,107.20	信用证保证金，受限
通富超威槟城	中行马来西亚分行	1,014.41	保函保证金，受限
合计		60,012.09	

截至 2020 年 12 月 31 日，公司其他货币资金余额为 129,700.89 万元，其中 114,093.07 万元为定期存款、协定存款，剩余为信用证保证金等受限资金。具体存放情况如下：

存放主体	开户行	金额（万元）	是否受限
通富微电	中国银行南通分行	692.08	信用证保证金，受限
通富微电	招商银行南通分行	36,000.00	定期存款，不受限
通富微电	中国工商银行江苏省南通分行	60.90	信用证保证金，受限
通富微电	江苏银行南通崇川支行	135.45	信用证保证金，受限
通富微电	中国建设银行南通崇川支行	2,200.00	信用证保证金，受限
通富微电	中国农业银行南通分行营业部	2,104.22	信用证保证金，受限
通富微电	招商银行南通分行	360.00	信用证保证金，受限
通富微电	交通银行南通分行台商投资开发区支行	220.00	信用证保证金，受限

通富微电	兴业银行南通分行营业部	17.10	信用证保证金, 受限
通富微电	浙商银行南通分行	650.00	信用证保证金, 受限
通富微电	上海浦东发展银行南通分行	1,132.94	信用证保证金, 受限
南通通富	交通银行南通城东支行	5,417.00	信用证保证金, 受限
南通通富	招商银行南通分行	665.00	信用证保证金, 受限
南通通富	国家开发银行江苏省分行	6,100.00	定期存款, 不受限
南通通富	国家开发银行江苏省分行	3,921.45	协定存款, 不受限
合肥通富	中国建设银行合肥经济技术开发区支行	914.60	信用证保证金, 受限
通富超威苏州	中国建设银行苏州工业园区支行	3,262.45	定期存款, 不受限
通富超威苏州	中国建设银行苏州工业园区支行	9,787.35	定期存款, 不受限
通富超威苏州	中国建设银行苏州工业园区支行	4,893.68	定期存款, 不受限
通富超威苏州	宁波银行江苏自贸试验区苏州片区支行	10,000.00	定期存款, 不受限
通富超威苏州	中国农业银行苏州姑苏支行	13,702.29	定期存款, 不受限
通富超威苏州	中国农业银行苏州姑苏支行	3,262.45	定期存款, 不受限
通富超威苏州	中国农业银行苏州姑苏支行	8,156.13	定期存款, 不受限
通富超威苏州	中国农业银行苏州姑苏支行	15,007.27	定期存款, 不受限
通富超威槟城	中国银行吉隆坡分行	1,038.54	保函保证金, 受限
合计		129,700.90	

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司其他货币资金余额为 21,472.56 万元, 全部为信用证保证金等受限资金。具体存放情况如下:

存放主体	开户行	金额 (万元)	是否受限
通富微电	中国银行南通分行	500.00	保函保证金, 受限
通富微电	兴业银行股份有限公司南通分行	40.00	银行承兑汇票保证金, 受限
通富微电	中国工商银行江苏省南通分行	60.90	信用证保证金, 受限
通富微电	江苏银行股份有限公司南通崇川支行	135.45	信用证保证金, 受限
通富微电	中国建设银行南通市崇川支行	987.90	信用证保证金, 受限
通富微电	中国农业银行南通分行营业部	1,996.60	信用证保证金, 受限
通富微电	兴业银行股份有限公司南通分行	3,388.40	信用证保证金, 受限
通富微电	中信银行股份有限公司南通分行	2,619.46	信用证保证金, 受限
通富微电	浙商银行股份有限公司南通分行	318.18	信用证保证金, 受限

通富微电	兴业银行股份有限公司南通分行	1,800.00	信用证保证金, 受限
通富微电	苏州银行股份有限公司南通分行	253.80	信用证保证金, 受限
通富微电	上海浦东发展银行南通分行	3,113.26	信用证保证金, 受限
合肥通富	中国建设银行合肥经开区支行	873.60	信用证保证金, 受限
南通通富	交通银行南通城东支行	3,728.70	信用证保证金, 受限
南通通富	兴业银行股份有限公司南通分行	599.10	信用证保证金, 受限
通富超威槟城	中国银行吉隆坡分行	1,057.21	保函保证金, 受限
合计		21,472.56	

截至 2018 年 12 月 31 日, 公司其他货币资金余额为 13,703.59 万元, 全部为信用证保证金等受限资金。具体存放情况如下:

存放主体	开户行	金额 (万元)	是否受限
通富微电	江苏银行股份有限公司南通崇川支行	943.53	信用证保证金, 受限
通富微电	交通银行南通分行台商投资开发区支行	358.00	信用证保证金, 受限
通富微电	苏州银行股份有限公司南通分行	152.40	信用证保证金, 受限
通富微电	兴业银行股份有限公司南通分行	2,810.88	信用证保证金, 受限
通富微电	招商银行股份有限公司南通分行	825.00	信用证保证金, 受限
通富微电	浙商银行股份有限公司南通分行	1,412.95	信用证保证金, 受限
通富微电	中国工商银行江苏省南通分行	610.79	信用证保证金, 受限
通富微电	中国建设银行南通市崇川支行	987.90	信用证保证金, 受限
通富微电	中国农业银行南通分行营业部	49.70	信用证保证金, 受限
通富微电	中国银行南通分行	5.22	信用证保证金, 受限
通富微电	中国银行南通分行	500.00	保函保证金, 受限
通富微电	中信银行股份有限公司南通分行	2,938.48	信用证保证金, 受限
南通通富	中国建设银行南通崇川支行	100.00	信用证保证金, 受限
南通通富	交通银行南通城东支行	550.00	信用证保证金, 受限
合肥通富	中信银行合肥滨湖支行	513.95	信用证保证金, 受限
通富超威槟城	中国银行槟城分行	944.79	保函保证金, 受限
合计		13,703.59	

由上表可见, 公司其他货币资金主要为开展正常进口采购业务形成的信用证保证金, 符合进口通常采用的结算模式。

（三）是否存在存单质押、与控股股东资金池担保等使用受限情形

公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人及关联方保持独立。公司银行账户均由公司及子公司独立开立，各主体独立支配账户内资金。公司不存在与控股股东及关联方资金共管、银行账户归集等情形。报告期内，公司不存在存单质押的情况；不存在与控股股东资金池担保等使用受限的情形。

根据致同会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

综上所述，报告期内，公司对货币资金管理高度重视，建立并持续完善内部控制体系，加强对货币资金的内部管理，除库存现金外，银行存款和其他货币资金均存放于公司名下各银行账户中。公司严格遵守自有资金独立管理原则，货币资金管理符合独立性要求，使用受限资金主要系采购进口设备的信用证保证金等，报告期内，公司不存在存单质押的情况，不存在与控股股东资金池担保等使用受限的情形。

二、说明在货币资金较为充裕情况下，短期借款及长期借款余额较高的原因及合理性。

公司报告期各期末货币资金余额、短期借款余额、长期借款余额情况如下：

单位：万元

项目	2021.09.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
货币资金	425,949.87	412,099.73	222,469.49	137,283.38
短期借款（含 1 年到期的长期借款）	405,915.90	406,728.83	458,156.01	294,846.31
长期借款	379,427.33	244,881.21	75,809.56	36,079.96

报告期内，公司货币资金余额呈增长趋势。2020 年末，由于公司前次募集资金到账，货币资金增加较多，且由于公司前次募投项目实施所需资金量较大，同时，收入规模快速增长所需的营运资金增加，导致公司近一年货币资金金额相对较高。随着公司前次募投项目的逐步实施，截至 2021 年 11 月 30 日，公司货币资金余额降低到 31.20 亿元。

报告期各期末，在货币资金余额较大的情况下，公司短期借款及长期借款余额较高的原因及合理性如下：

（一）集成电路封测行业是资金、技术密集型行业，生产规模的扩大需要持续的资金投入

公司所处的集成电路封装测试行业属于资金密集型行业，技术升级及研发活动、原材料采购、人员工资、产线建设等都需要大量的资金投入。首先，集成电路封测行业对技术的要求较高，需要长期持续的研发投入以保持技术的先进性；其次，集成电路封测行业不断扩产过程中，需要购置大量的高端设备、新建或改造厂房、扩充或升级生产线以不断满足产能扩张的需求；再次，集成电路封测行业需要大量的流动资金来支付原材料采购款、员工工资等，用以维持日常的生产经营活动。

报告期内，受益于全球半导体行业的持续发展、公司技术实力的稳步提升以及与行业内知名客户合作的不断深化，公司销售收入呈现出良好的增长趋势。2018年、2019年、2020年和2021年1-9月，公司营业收入分别为722,286.30万元、826,657.46万元、1,076,870.00万元和1,120,360.64万元。2018年至2020年，公司营业收入复合增长率为22.10%，2021年1-9月，公司营业收入同比增长51.00%。

随着公司生产规模的持续扩大，对货币资金的需求持续增长。报告期内，公司销售收入增长的同时，应收款项、存货、预付款项的规模相应提高，报告期各期末合计分别为310,688.90万元、366,886.03万元、344,271.63万元及411,711.29万元，较大数额的应收款项、存货和预付款项对公司日常营运资金形成了一定压力，资金需求较高。

除自身积累外，公司主要通过股权、银行借款等方式融资，相比于股权融资，银行借款融资有一定的便利性，公司在报告期内通过银行借款满足部分资金需求。

近三年一期，公司主要现金支出情况如下：

单位：万元

项 目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
购买商品、接受劳务支付的现金	759,502.14	698,987.82	584,654.14	538,458.24
支付给职工以及为职工支付的现金	144,511.04	159,225.47	121,980.34	110,329.91
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,892.62	362,995.05	210,876.00	223,076.42
合计	1,325,905.80	1,221,208.34	917,510.48	871,864.57

(二) 公司期末货币资金均有着明确的用途，不能主要用于归还银行借款

截至2021年9月30日，公司持有的货币资金共计425,949.87万元，持有交易性金融资产43,685.29万元，合计469,635.16万元。前述资金均有着明确的使用计划，汇总如下：

序号	项目或用途	金额（万元）
1	截至2021年9月30日货币资金及交易性金融资产余额	469,635.16
2	受限制资金（信用证保证金、保函保证金）	54,497.68
3	前次募投项目实施所需资金（扣除用于购买前次募投项目实施购买设备的信用证保证金金额）	183,493.30
4	子公司通富超威槟城扩产项目	41,182.60
5	日常经营所需营运资金	125,541.06
6	用于未来1个月银行借款偿还	47,527.78
7	拟新设子公司投资	47,000.00
8	拟新增对外投资	10,240.00
9	剩余资金（1-2-3-4-5-6-7-8）	-39,847.26

1、受限制资金

受限资金余额为54,497.68万元，主要用于信用证、保函等存入的保证金，上述资金最终用于购买原材料及设备。由于封测行业特点及公司客户中海外客户占比较高，公司日常经营中较多使用信用证及保函等方式与供应商进行结算，以至于公司各期信用证保证金、保函保证金等受限资金金额较大。

2、前次募集资金投资项目需继续投资金额

为持续扩大生产规模，公司前次募集资金拟投资总额为540,800.00万元，其中，前次募集资金拟投入324,534.90万元，以自有资金投入216,265.10万元。截至2021年9月30日，扣除“补充流动资金及偿还银行贷款”后，项目投资总额

合计 438,800.00 万元,已投资金额 229,296.70 万元,拟继续投资金额为 209,503.30 万元,其中募集资金继续投资金额为 106,486.07 万元,公司以自有资金继续投资 103,017.23 万元。

单位: 万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额	自筹资金已投入金额	已投入金额合计
1	集成电路封装测试二期工程	258,000.00	76,020.00	65,990.07	104,150.77	170,140.84
2	车载品智能封装测试中心建设	118,000.00	103,000.00	19,086.62	2,612.00	21,698.62
3	高性能中央处理器等集成电路封装测试项目	62,800.00	50,000.00	37,457.24	0.00	37,457.24
合计		438,800.00	229,020.00	122,533.93	145,856.61	229,296.70

截至 2021 年 9 月 30 日,拟继续投资的 209,503.30 万元中,用于购买设备的 26,010.00 万元款项已进入信用证保证金账户,扣除该金额后,前次募投项目实施所需资金为 183,493.30 万元。

3、子公司通富超威槟城扩产项目

2021 年以来,由于客户 AMD 等公司订单增长,子公司根据客户需求情况进行扩产,2021 年四季度计划购买设备支出 41,182.60 万元,用于扩大集成电路封装产能。

4、公司日常生产经营对资金需求较高

根据公司日常经营付现成本、费用等,并考虑公司资金周转率等因素,公司估算在现行运营规模下日常经营需要的营运资金保有量,具体测算如下:

$$2021 \text{ 年营运资金保有量} = 2020 \text{ 年度销售收入} \times (1 - 2020 \text{ 年度销售利润率}) \times (1 + \text{本年度预估销售增长率}) / \text{营运资金周转次数}$$

根据公司 2020 年度财务报表,2020 年销售收入为 1,076,870.00 万元,公司营业利润率为 3.35%,假设公司 2021 年预计的增长率与 2020 年较 2019 年的增长率一致,按照 30.27% 计算。

营运资金周转天数 = 存货周转期 + 应收账款周转期 - 应付账款周转期 + 预付账款周转期 - 预收账款周转期 = 33.33 天

营运资金周转次数=360/营运资金周转天数=10.80

2021 年营运资金保有量=2020 年度销售收入×(1-2020 年度销售利润率)×(1+本年度预估销售增长率)/营运资金周转次数=1,076,870.00 万元×(1-3.35%)×30.27%/10.80=125,541.06 万元

5、偿还银行借款

集成电路封测行业投资规模大，公司需要通过银行间接融资来维持公司生产规模的扩大及研发投入的可持续，公司在日常经营中，需要保有一定的货币资金量，用以偿还 1 个月以内到期的银行借款。

6、拟新设子公司投资

2021 年 9 月，发行人设立全资子公司通富微电科技（南通）有限公司，注册资本 8,000 万元，主营业务为集成电路相关技术研发，主要承担发行人部分产业相关技术的研发和试验工作。2021 年 10 月，发行人设立全资子公司通富通科（南通）微电子有限公司，注册资本 3.9 亿元，该公司未来建成运营后，将成为公司集成电路封测产品的新生产基地。

7、拟新增对外投资

2021 年 9 月，发行人与南通江海电容器股份有限公司、江苏华存电子科技有限公司、南通越亚半导体有限公司等公司共同设立南通市协同创新半导体科技有限公司，主营业务为集成电路相关技术服务、开发及咨询，注册资本 1,000 万元，发行人持股 24.00%。2021 年 10 月，发行人与上海华虹投资发展有限公司、长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）、上海虹方企业管理合伙企业（有限合伙）共同设立半导体产业投资基金上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙），基金总规模为 10 亿元人民币，公司前期认缴 1 亿元。

综上，公司 2021 年 9 月末的货币资金中，主要用于前次募投项目的继续实施以及维持公司日常的经营活动，且随着公司 2021 年以来业绩的高速增长，公司有一定的资金缺口待新的流动资金补充。公司的期末货币资金如果主要用以偿还银行借款，则会对公司正常的生产经营活动产生不利影响。

（三）有息负债较高的情形符合同行业公司经营惯例

由于集成电路封装测试行业属于资金密集型行业，技术升级及研发活动、原材料采购、人员工资、产线建设等都需要大量的资金投入。同行业上市公司同样存在短期借款、长期借款金额与银行存款余额同时较高的情形。

报告期各期末，同行业上市公司货币资金、短期借款、长期借款具体情况如下：

单位：亿元

同行业上市公司	项 目	2021.09.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
长电科技 (600584)	货币资金余额	29.80	22.35	25.69	47.74
	短期借款余额（包括一年内到期长期负债）	51.83	74.19	109.25	124.09
	长期借款余额	24.15	29.78	15.84	29.34
华天科技 (002185)	货币资金余额	33.51	29.07	21.28	30.97
	短期借款余额（包括一年内到期长期负债）	31.80	21.75	17.91	24.94
	长期借款余额	34.08	20.52	15.06	13.74
公司	货币资金余额	42.59	41.21	22.25	13.73
	短期借款余额（包括一年内到期长期负债）	42.37	43.10	50.41	30.71
	长期借款余额	37.94	24.49	7.58	3.61

注：以上数据来源于上市公司公告

如上表，由于集成电路封测行业投资规模大，同行业上市公司均存在大额银行借款融资的情形，同时，由于日常经营活动所需的资金较多，同行业上市公司均持有金额相对较大的货币资金以保证公司正常的经营活动不受影响。

综上所述，公司期末持有的货币资金有着明确的使用规划，不存在大额资金长期闲置的情形。由于集成电路封装测试行业属于资金密集型行业，技术升级及研发活动、原材料采购、人员工资、产线建设等都需要大量的资金投入，公司在报告期内通过银行借款满足部分资金需求具有合理性。

三、核查情况

（一）核查程序

保荐机构及会计师获取了公司的资金管理辦法，了解、评价和测试与货币资金相关的关键内部控制设计和运行的有效性；获取了公司银行账户的对账单，并

对全部银行账户进行了函证；获取了银行开户清单，与公司账面记载情况进行核对，确定银行账户的完整性和使用的合规性；对公司长、短期借款及信用证开证情况执行了函证程序；获取企业信用报告，与公司融资、担保情况进行核对；查阅了公司借款、担保及抵押合同等；分析复核利息收入、利息支出的合理性；对银行存款发生额执行大额双向核对。

（二）核查结论

经核查，保荐机构认为：

1、公司的银行存款均存放在各信用良好、有实力的银行类金融机构中，所有账户的开设均为开展经营、借贷必要。公司其他货币资金主要为信用证保证金，符合进口通常采用的结算模式。不存在存单质押或与控股股东资金池担保等使用受限的情形。

2、公司期末持有的货币资金有着明确的使用规划，不存在大额资金长期闲置的情形。由于集成电路封装测试行业属于资金密集型行业，技术升级及研发活动、原材料采购、人员工资、产线建设等都需要大量的资金投入，公司在报告期内通过银行借款满足部分资金需求具有合理性。

3、通富微电账面货币资金余额较大，同时短期借款及长期借款余额较高的情况与同行业上市公司情况相同，具有合理性。

经核查，会计师认为：“我们没有发现公司上述回复中与财务报告相关的信息与我们在审计过程中获取的相关资料在所有重大方面存在不一致。我们认为，公司货币资金不存在存单质押、与控股股东资金池担保等使用受限情形；在货币资金较为充裕情况下，短期借款及长期借款余额较高具有合理性。”

问题 4、关于商誉

根据申报材料，2020 年末商誉账面金额 10.06 亿元，未计提商誉减值准备。对于 2020 年末商誉减值测试，请申请人：

(1) 补充说明相关资产组预测期收入增长率预测值的具体确定依据及合理性；(2) 预测期费用率为 4.18%至 4.39%，明显低于报告期内平均费用 5.61%，请补充说明期间费用率预测值的具体确定依据及合理性。请保荐机构、申报会计师说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。

回复：

一、补充说明相关资产组预测期收入增长率预测值的具体确定依据及合理性；

(一) 相关资产组近 3 年实际收入增长率及预测期收入增长率情况

单位：万元

项目	最近三年			预测期				
	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
营业收入	324,647.55	432,941.98	595,510.58	772,698.42	930,470.54	1,079,181.51	1,227,446.80	1,385,446.58
营业收入增长率	9.85%	33.36%	37.55%	29.75%	20.42%	15.98%	13.74%	12.87%
复合增长率	35.44%			18.40%				

(二) 收入预测过程

通富超威苏州和通富超威槟城截至目前收入主要来源于 AMD。AMD 为通富超威苏州和通富超威槟城长期稳定的战略合作伙伴，其他客户为收购后新开拓的客户，为通润达公司新的业务增长点。2021 年通润达公司收入预测是基于现有客户的年度经营计划、通润达公司生产计划和产能情况等因素而制定；2021 年期后预测期内收入增长率预测主要参照历史数据并出于谨慎性考虑进行一定程度的下调。

(三) 收入预测依据及合理性分析

1、收入预测增长系基于对半导体产业发展持续向好的判断

2019 年下半年至今，存储器、高性能计算、5G 通信、物联网、数据中心、

汽车电子等应用领域快速发展。随着下游产业需求逐渐回暖，全球半导体产业恢复增长，行业景气度显著回升。2020 年全球集成电路市场规模达到 3,612 亿美元，同比增长 9.32%。根据中国半导体行业协会统计数据，从 2011 年到 2020 年中国半导体市场规模从 1,934 亿元扩大至 8,848 亿元，年均复合增长率为 18.41%，明显高于全球集成电路市场的增速。同时，中国集成电路产业销售额占全球市场的比重持续增长，2020 年占比达到 40%，中国已成为全球最大、增速最快的集成电路市场。

CPU 是计算机的运算和控制核心，作为算力基础，是整个科技行业的底座，是多个创新方向的基础支撑。伴随 5G、云计算、物联网、大数据、人工智能等创新领域的发展，对算力的需求也大幅增加，CPU 的市场需求广阔。具体来看，无论是 5G、云计算、大数据相关的科技领域基础设施的搭建，还是 5G 手机、AR/VR 等终端设备的更新更替，还是人工智能、智能驾驶等应用层级的创新，均对算力提出了更高的要求。后续 CPU 在这些领域的增量应用或将打开 CPU 更大的市场空间。

GPU 是计算机上做图像和图形相关运算工作的微处理器。3D 图像显示、人工智能深度学习的需求支撑 GPU 市场持续增长。据 Verified Market Research 数据，2020 年全球 GPU 市场规模达到 999.1 亿美元，预计 2028 年将达到 1,581.6 亿美元，年复合增长率为 5.9%。

2、收入预测增长系基于主要客户 AMD 业务增长

AMD 是通富超威苏州和通富超威槟城最主要的客户，其 80% 以上的产品在通富超威苏州及通富超威槟城进行封测。AMD 是目前业内可以提供高性能 CPU、高性能独立显卡 GPU、主板芯片组三大组件的半导体公司，2020 年度量产超过 20 种 7nm 制程的 PC、游戏和数据中心产品。根据 AMD 披露的 2020 年年报，AMD 2020 年全年营收 97.6 亿美元，同比增长 45%，主要原因是个人电脑市场增长，锐龙处理器销量增加，以及 EPYC 处理器在云服务、企业和高性能计算客户中的应用显著加速。

根据 AMD 发布的 2021 年季报数据，2021 年前三季度实现营收 116.08 亿美元，同比增长 78.06%。

通富超威苏州及通富超威槟城与 AMD 已形成稳定的合作模式，每年期初双方都会就生产经营计划、预算、在产品以及技术路线、合作研发、新产品导入、产能利用和新投入资产等进行讨论，相关事项均需得到双方的认可。因此，2021 年通润达公司来源于 AMD 的收入预测系基于 AMD 可预测的业务增长，源于双方共同认可的生产计划；2021 年期后预测期内，基于 AMD 持续发挥制程优势、提升市占率的良好发展前景，通润达公司来自于 AMD 收入的增长率预测主要参照历史数据并出于谨慎性考虑进行一定程度的下调。综上，通润达公司在预测期内对 AMD 销量和收入的增长预测，均有相应的依据，且可以预期。

3、收入预测增长系基于国产化趋动下的收入增长

我国 CPU 市场规模和潜力非常大，庞大的整机制造能力意味着巨量的 CPU 采购。同时，服务器 CPU 伴随着整机出货的快速成长，需求量增长也较为迅速。IDC《2020 年第四季度中国服务器市场跟踪报告》显示，2020 年中国服务器市场出货量为 350 万台，同比增长 9.8%；市场规模为 216.49 亿美元（约合 1,489.9 亿元人民币），同比增长 19.0%。近两年，采用国产 CPU 的桌面和服务器产品发展迅速，但市场份额仍不足 5%，增长空间巨大。IDC 预计，随着国家十四五规划的推进以及新基建的投资，未来五年中国服务器市场将保持健康稳定的增长。2021-2025 年，中国服务器市场规模将由 257.31 亿美元升至 410.29 亿美元，保持 12.5% 的年复合增长率。

根据 IDC 数据，2020 年，中国 GPU 服务器市场规模为 27.6 亿美元，预计到 2024 年将达 60 亿美元，即 380 亿元左右，年复合增长率（CAGR）为 21.43%。

通富超威苏州及通富超威槟城具有国际高端的 CPU、GPU 等封装测试技术，利用技术领先优势，除满足主要客户 AMD 的业务需求外，积极导入其他客户，在半导体国产化的大背景下，根据市场预期及已开发客户和潜在客户的经营情况，预测 2021 年及以后年度相关业务将会保持快速增长。

综上，相关资产组收入增长率主要依据是在半导体产业发展持续向好的背景下，主要客户 AMD 强劲的发展态势和国产化驱动下的其他客户业务收入增长，从整个预测期角度分析相关资产组预测收入增长率总体不高，相关业务收入预测有客户经营计划和公司相关预算的支撑，因此，相关资产组 2021 年收入增长率

以及期后各期预测数据增长率依据充分且具有合理性。

二、预测期费用率为 4.18%至 4.39%,明显低于报告期内平均费用 5.61%,请补充说明期间费用率预测值的具体确定依据及合理性。

(一) 通润达公司近年来的期间费用（销售费用、管理费用、研发费用）实际情况及预测情况

单位：万元

项目	最近三年			预测期				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
营业收入	324,647.55	432,941.98	595,510.58	772,698.42	930,470.54	1,079,181.51	1,227,446.80	1,385,446.58
收入增长率	9.85%	33.36%	37.55%	29.75%	20.42%	15.98%	13.74%	12.87%
销售费用	114.70	300.33	380.25	441.59	538.69	642.49	753.92	875.42
管理费用	7,003.50	8,386.08	9,751.51	10,323.62	12,189.02	13,690.90	15,526.89	18,174.88
研发费用	10,925.25	19,154.78	20,175.04	23,160.52	27,727.93	31,572.00	35,016.21	39,084.55
期间费用率（不含财务费用）	5.30%	6.43%	5.09%	4.39%	4.35%	4.25%	4.18%	4.20%

注：最近三年期间费用率未考虑汇兑损益、利息收入及手续费的影响。如考虑该因素，则最近三年平均期间费用率（不含利息支出）为 5.25%。

通润达公司下属生产经营实体主要是通富超威苏州、通富超威槟城，预测期间管理费用以通润达公司基期期间费用水平作为参考，并结合未来通润达公司规模扩大、销售及管理人员数量及薪酬变化、研发投入预期等进行了合理预测；从预测金额来看，通润达公司销售费用、管理费用和研发费用预测期内均保持了一定规模的持续增长。同时随着营收规模的不断增长、规模效应不断显现，预测期间费用率较报告期内略有降低，但仍维持合理水平。

(二) 各项费用分析

1、销售费用

通润达公司最近三年销售费用的实际情况及预测值：

单位：万元

项目	最近三年			预测期				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
销售费用	114.70	300.33	380.25	441.59	538.69	642.49	753.92	875.42
销售费用增长率	1.41%	161.85%	26.61%	16.13%	21.99%	19.27%	17.34%	16.12%
销售费用占营业	0.04%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%

项目	最近三年			预测期				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
收入比例								

通润达公司下属通富超威苏州、通富超威槟城主要承接 AMD 的封装业务订单，其他对外销售业务相对较少，销售费用占营业收入比例较低；随着通润达公司营收规模扩大，预测期销售费用逐年增长，占营业收入的比例与最近三年基本持平。

2、管理费用

通润达公司最近三年管理费用的实际情况及预测值：

单位：万元

项目	最近三年			预测期				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
管理费用	7,003.50	8,386.08	9,751.51	10,323.62	12,189.02	13,690.90	15,526.89	18,174.88
管理费用增长率	23.32%	19.74%	16.28%	5.87%	18.07%	12.32%	13.41%	17.05%
管理费用占营业收入比例	2.16%	1.94%	1.64%	1.34%	1.31%	1.27%	1.26%	1.31%

通润达公司管理费用主要为管理人员薪酬、折旧及摊销、IT 费用及服务费等组成。最近三年，管理费用金额虽逐年增长，但占营业收入的比例逐渐下降，由 2.16% 降低至 1.64%，主要是由于规模效应的影响。预测期内，通润达公司考虑到管理人员的数量、薪酬变化、折旧及摊销、IT 费用等因素的影响，预测金额稳定增长。受益于规模效应，营业收入增幅高于管理费用增幅，导致管理费用占营业收入的比例略低于最近三年平均比例 1.91%，维持在 1.26%-1.34%，具有合理性。

3、研发费用

通润达公司最近三年研发费用的实际情况及预测值：

单位：万元

项目	最近三年			预测期				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
研发费用	10,925.25	19,154.78	20,175.04	23,160.52	27,727.93	31,572.00	35,016.21	39,084.55
研发费用增长率	103.49%	75.33%	5.33%	14.80%	19.72%	13.86%	10.91%	11.62%
研发费用占营业	3.37%	4.42%	3.39%	3.00%	2.98%	2.93%	2.85%	2.82%

项目	最近三年			预测期				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
收入比例								

2018年、2019年，通富超威苏州和通富超威槟城为配合AMD布局高端先进封装产品，在7nm等系列新产品的联合开发上进行了较大研发投入。同时，为开拓国内新客户需求，通富超威苏州和通富超威槟城研发项目出现项目数量和研发金额大幅增长的情况，导致研发费用占营业收入比例较高。随着7nm等系列新产品陆续量产，2020年度通润达公司研发投入占营业收入的比例较2019年度有所回落。2020年商誉减值测试时，通润达公司判断2018年-2019年研发费用大幅增长的情况属于较为特殊的情形，以后年度研发投入应维持继续稳定增长的趋势。为保持与客户新品投入节奏匹配，通润达公司根据AMD的长期产品投入计划和对国内客户的市场预测，规划了未来研发活动的总体方向、目标，并基于此测算了预测期内的研发费用。预测期内，通润达公司研发投入不断增长，年增长率均超过10%，研发费用预测符合公司的研发活动安排，具有合理性；同时，通富超威苏州和通富超威槟城的技术积累推动通润达公司业务持续增长，收入增长率高于研发费用增长率，导致研发费用占营业收入比例有所下降，相关情形符合通润达公司业务发展的实际情况，具有合理性。

综上，通润达公司期间费用率预测已充分考虑通润达公司规模效应、研发投入、管理及销售业务变化等因素对相关预测数据的具体影响，与历史数据趋势相符、与收入预测相匹配，具有合理性。

三、核查情况

（一）核查程序

保荐机构、申报会计师执行了以下核查程序：

- 1、了解与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值金额的复核及审批；
- 2、评价管理层进行减值测试时所聘请评估师的胜任能力、专业素质和客观性，与评估师讨论资产组的认定，并复核估值方法和关键参数；
- 3、查阅主要客户AMD和国内客户公开信息、研究报告等；

4、对研发费用、管理费用实施分析性程序并针对大额研发费用执行了细节测试程序，并对已开展、计划开展的研发项目进行了了解；

5、通过将相关资产组以前年度的预测数据与实际数据进行比较，评价管理层对现金流量预测的可靠性；

6、评估管理层进行减值测试相关的关键假设和折现率，检查未来现金流的预测和未来现金流现值的计算；

7、复核财务报表附注中与商誉减值相关的披露。

（二）核查结论

经核查，保荐机构认为：发行人基于 AMD 等客户的经营规划、行业发展趋势等情况确定相关资产组预测期的收入增长率，具有合理性；期间费用率预测已充分考虑通润达公司规模效应、研发投入、管理及销售业务变化等因素对相关预测数据的具体影响，与历史数据趋势相符、与收入预测相匹配，具有合理性。

经核查，会计师认为：“我们没有发现公司上述回复中与财务报告相关的信息与我们在审计过程中获取的相关资料在所有重大方面存在不一致。我们认为，相关资产组预测期收入增长率预测值具有合理性；期间费用率预测值具有合理性。”

（本页无正文，为通富微电子股份有限公司《关于通富微电子股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复》之盖章页）

通富微电子股份有限公司

2022年1月6日

（本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于通富微电子股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

程 韬

许国利

保荐机构董事长签名： _____

周 杰

海通证券股份有限公司

2022年1月6日

声明

本人已认真阅读通富微电子股份有限公司本次发审委会议准备工作函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构董事长签名：_____

周 杰

海通证券股份有限公司

2022年1月6日